

# Ustna vprašanja in odgovori - Elektronske komponente in senzorji

---

Vprašanja:

[Ustna vprašanja](#)

Literatura:

[EK-Prosojnice.pdf](#)

## Upori

---

### 1. Definicija zanesljivosti (ang. reliability)? Kaj je POGOSTOST ODPOVEDI (Failure Rate, FR)?

Zanesljivost elektronskega elementa ali sistema je verjetnost, da bo deloval v okviru zjamčenih podatkov proizvajalca pod predpisanimi pogoji delovanja preko zjamčenega časovnega obdobja, pri čemer število odpovedi ne presega obljubljenega! Je verjetnost preživetja elementa

FR je razmerje med :

- število vseh odpovedi in
- številom prisotnih elementov N
- časom delovanja t.

$$FR = \frac{\text{št.odpovedi}}{Nt}$$

### 2. Razložite pojme FIT, MTTR, MTTF in MTBF? (Podajte primer za MTBF)

Mean Time Between Failures (MTBF)

- Število odpovedi na milijon ur delovanja izdelka
- Je najbolj razširjen podatek o življenjski dobi izdelka
- Je bolj pomemben podatek za industrijo kot za potrošnika
- Zanesljivost popravljivega izdelka opišemo običajno z MTBF
- Zanesljivost nepopravljivega izdelka opišemo običajno z MTTF (Mean Time To Failure)

Mean Time To Repair (MTTR)

- Čas, potreben za popravilo okvarjenega elementa.
- V delujočem sistemu gre običajno za zamenjavo elementa

- MTTR je zato ponavadi povprečni čas, potreben za zamenjavo elementa
- Če MTTR narašča, to običajno podraži dolgoročno uporabo, zaradi časa nedelovanja (down-time) dokler ne prispe nadomestni del.
- MTTR se uporabniki izognejo tako, da kupijo nadomestne dele na zalogo • Slednje je povezano s časom amortizacije elementa.

### Failure In Time (FIT)

- Je drugačen način podajanja MTBF.
- Podaja število predvidenih odpovedi na 10<sup>9</sup> ur delovanja elementa.
- FIT običajno opisujejo v enotah: – 1000 naprav / 10<sup>6</sup> ur – ali 106 naprav v 1000 urah.
- FIT se običajno podaja z intervalom zaupanja CL (Confidence Limits).

$$1FIT = 10^{-9} \frac{\text{odpovedi}}{\text{elementh}}$$

The Failures In Time (FIT) rate of a device is the number of failures that can be expected in one billion (10<sup>9</sup>) device-hours of operation.[14] (E.g. 1000 devices for 1 million hours, or 1 million devices for 1000 hours each, or some other combination.) This term is used particularly by the semiconductor industry.

### MTBF - Primer

- Enota je delovala 316 ur. Med tem je odpovedala 4x. Določite MTBF enote.
- $MTBF = 79 = 316(h)/(4 \text{ odpovedi})$

### Povprečni čas do odpovedi MTTF (Mean Time To Failure)

- MTTF je povprečni čas do odpovedi oz.
- MTTF je povprečni življenjski čas elementa

$$MTTF = \int_0^{\infty} t f(t) dt$$

$f(t)$  je funkcija verjetnostne gostote, ki nam podaja verjetnost za odpoved (Failure) na časovno enoto

### 3. Kaj sta Funkcija odpovedi (Failure function F(t)) in Funkcija zanesljivosti (Reliability function, R(t)). Kakšna je relacija med njima.

#### Funkcija odpovedi (Failure function F(t))

- Failure oz. Unreliability function

- $F(t)$  je verjetnost, da bo element, ki pravilno deluje v času  $t = 0$ , odpovedal do časa  $t$ .

Lastnosti  $F(t)$ :

- $t < 0 \implies F(t) = 0$  (element deluje do  $t = 0$ )
- $0 < t < t' \implies 0 < F(t) < F(t')$  (večji časi - večja verjetnost za odpoved)
- $t \rightarrow \infty \implies F(t) \rightarrow 1$  (vsak enkrat crkne)

Funkcija zanesljivosti (Reliability function,  $R(t)$ )

- $R(t)$  je verjetnost, da bo element, ki deluje v  $t = 0$ , preživel do časa  $t$
- $R(t)$  je verjetnostno nasprotje  $F(t)$ :

$$R(t) = 1 - F(t)$$

**4. Razložite pojem pogostost odpovedi: FR(t) in narišite krivuljo poteka "življenja elementa" (Reliability bathtub curve) ter opišite tri karakteristična področja krivulje.**

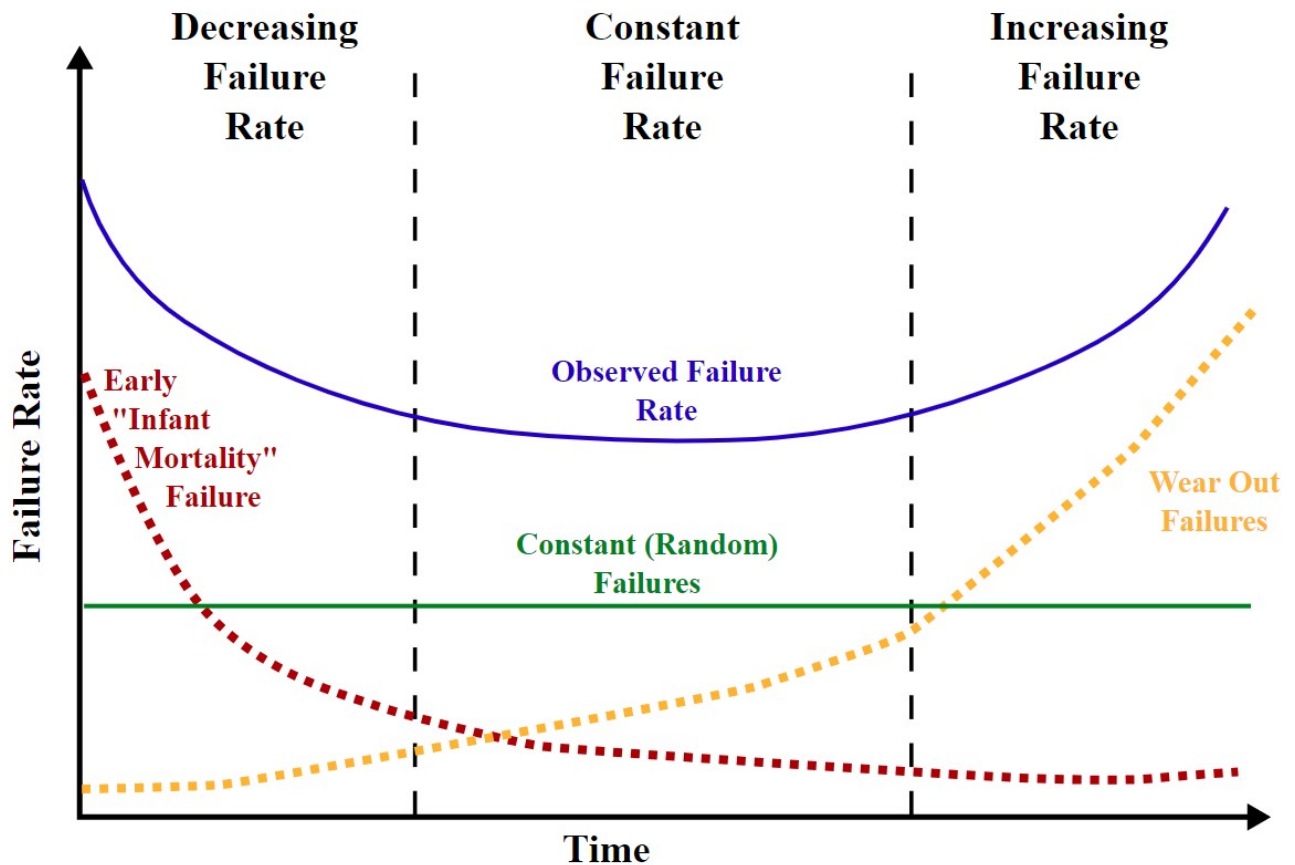
Pogostost odpovedi: FR(t) (Failure Rate)

- Je normirano število odpovedi na časovno enoto v trenutku  $t$ .
- Drugo ime:  $\lambda(t)$ .

$$\lambda(t) = FR(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

Potek "življenja elementa" (Reliability bathtub curve)

- Zgodnje odpovedi (ang. Infant mortality) grobe napake pri izdelavi (mehanske poškodbe, zamenjava materiala)
- Normalna uporaba (ang. random-constant failure mode) (padec na tla, zalitje z vodo, napetostni sunek)
- Iztrošenost (ang. wearout period) iztrošenost kritičnih materialov (oksidacija žarilne nitke v žarnici, korozija metalizacije v PCB/IC).



##### 5. Kaj podaja funkcija zanesljivosti $R(t)$ ?

Kateri del krivulje poteka "življenja elementa" opisuje eksponentna porazdelitev zanesljivosti?

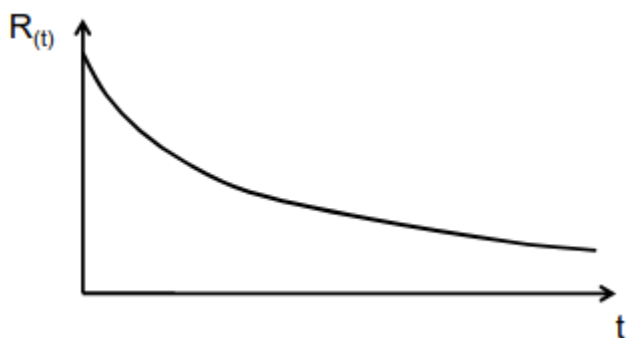
Katere dele krivulje poteka "življenja elementa" opisuje Weibullova porazdelitev zanesljivosti?

Funkcija zanesljivosti (Reliability function,  $R(t)$ )

- $R(t)$  je verjetnost, da bo element, ki deluje v  $t = 0$ , preživel do časa  $t$
- $R(t)$  je verjetnostno nasprotje  $F(t)$ :

$$R(t) = 1 - F(t)$$

- Izbor poteka  $R(t)$  je pogojen z lastnostmi mehanizmom odpovedi.
- Običajna oblika  $R(t)$ , ki jo srečamo v inženirskih problemih je eksponentno padajoča



Eksponentna porazdelitev zanesljivosti

- Eksponentna porazdelitev je primerna, kadar je pogostost odpovedi  $FR(t)$  neodvisna od časa.

- Uporabna za opis elementov v področju normalne uporabe (področje II banje).

$$FR(t) = \text{const} = FR_0$$

Weibullova porazdelitev zanesljivosti

- Weibullova porazdelitev lahko glede na vrednosti konstant  $\alpha$ ,  $\beta$ . opiše vsa tri področja banje.

$$\lambda = FR(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left( \frac{t}{\alpha} \right)^{\beta-1}$$

$\beta < 1 \implies FR$  upada s časom; (zgodnje odpovedi, področje 1 banje)

$\beta > 1 \implies FR$  raste s časom; (obdobje iztrošenosti, področje 3 banje)

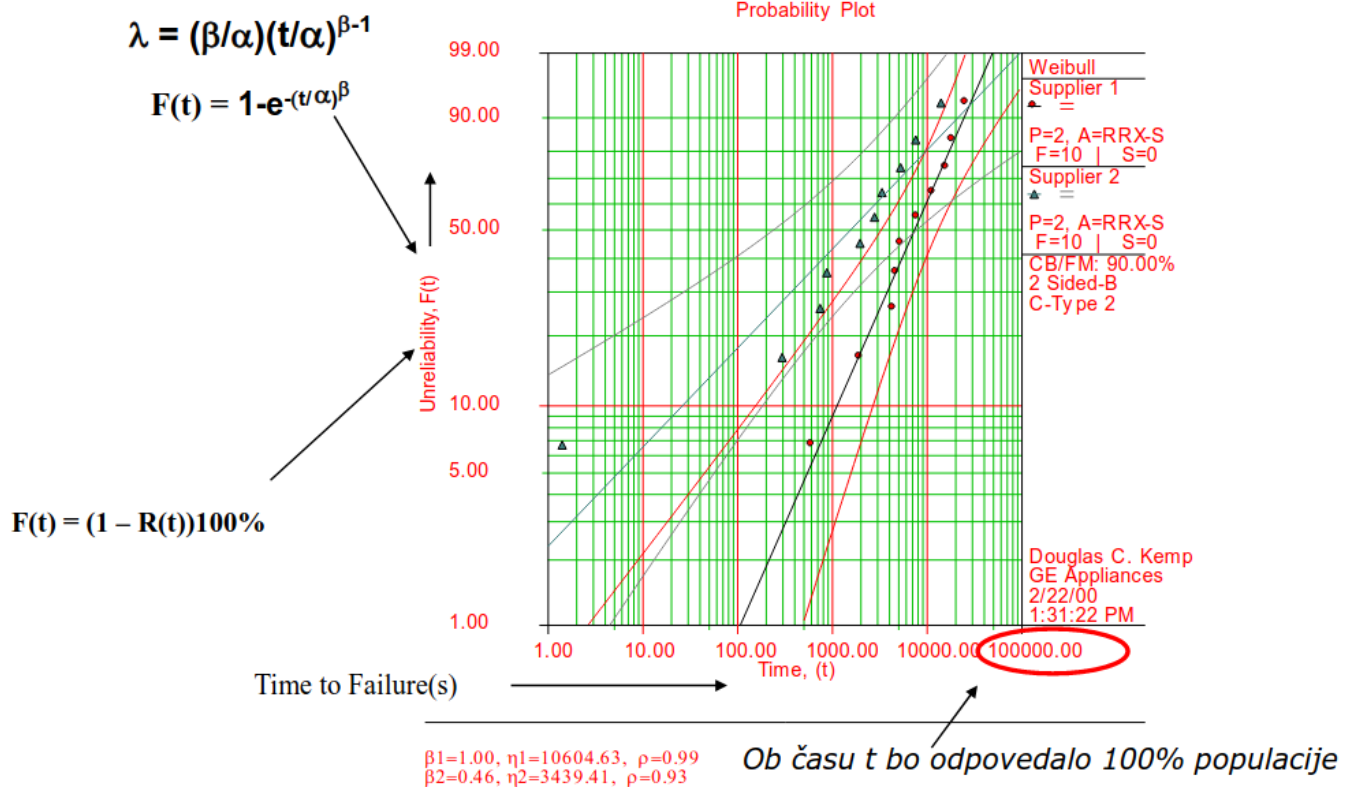
$\beta = 1 \implies FR$  se s časoma ne spreminja (normalne uporabe, področje 2 banje) enako eksponentni porazdelitvi

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$$

$$f(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left( \frac{t}{\alpha} \right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$$

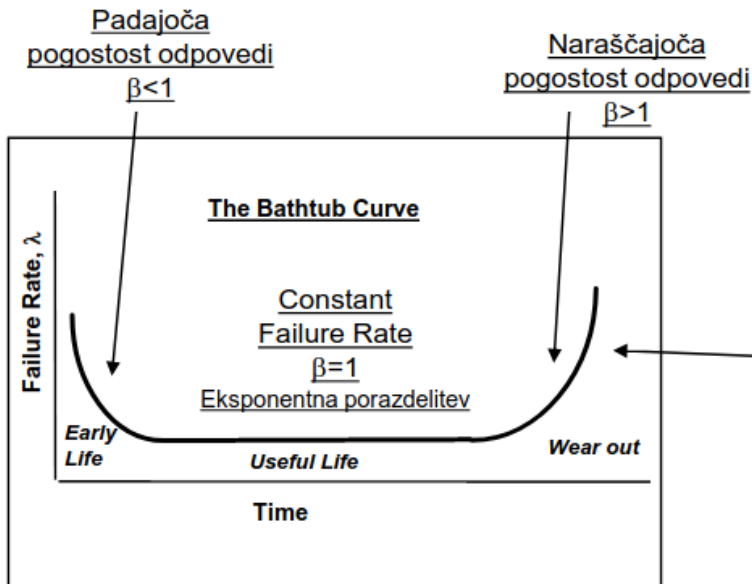
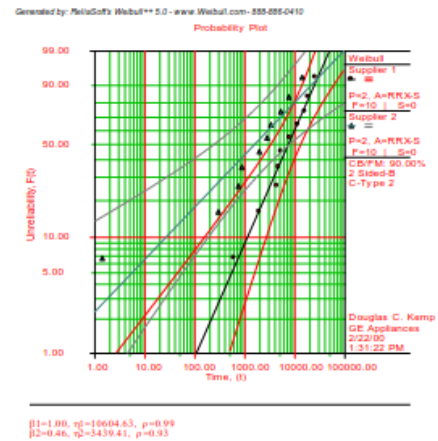
Potek funkcije odpovedi  $F(t)$  - Weibull



$$\lambda = (\beta/\alpha)(t/\alpha)^{\beta-1}$$

$$R(t) = e^{-(t/\alpha)^\beta}$$

$$F(t) = 1 - e^{-(t/\alpha)^\beta}$$



Naklon Weibullove karakteristike določa, kje točno na krivulji banje se nahaja izdelek

## 6. Kako različni faktorji obremenitve vplivajo na pogostost odpovedi?

Faktorji obremenitve (stress factor)

- Na pogostost odpovedi  $\lambda$  lahko vpliva več faktorjev obremenitve oz. obremenitev ( $\pi$ ):
- Splošno uporabljeni faktorji obremenitve
  - $\pi_T$  = Temperaturni
  - $\pi_V$  = Električni faktor obremenitve
  - $\pi_E$  = Okoljski faktor obremenitve
  - $\pi_Q$  = Faktor obremenitve kvalitete
- Pogostost odpovedi

$$\lambda = \lambda_B * \pi_T * \pi_V * \pi_E * \pi_Q$$

$\lambda_B$  = osnovna pogostost odpovedi komponente

## 7. Katere standarde s področja zanesljivosti poznate?

Standardi s področja zanesljivosti

- MIL-HDBK-217F
  - Izračun zanesljivosti elementa v obdobju zgodnjega cikla razvoja
  - Izračun zanesljivosti elementa v obdobju pozne cikla razvoja

- Bellcore (TR-TSY-000332):
  - Razvit v Bell Communications Research za splošno uporabo v elektronski industriji (in posebej za telekomunikacije)
  - Najvišji faktor obremenitve ima električna obremenitev
  - Podatki na osnovi testiranja delovanja v lab. in realnem okolju, analize, podatkovnih listov in standarda US MIL Std 217 – Faktorji obremenitve: okoljski, kvaliteta, električni, termični
- HRD4 (Hdbk of Reliability Data for Comp, Issue 4):
  - Razvit za telekomunikacije (British Telecom Materials and Components Center)
  - Vključuje faktorje obremenitve termična, električna, okoljska, obremenitev kvalitete
  - Standard describes generic failure rates based upon a 60% confidence interval around data collected via telecom equipment field performance in the UK
- CNET:
  - Razvit za telekomunikacije (Francoski nacionalni center za komunikacije)
  - Podoben HRD4, vključuje faktorje obremenitve termična, električna, okoljska, obremenitev kvalitete je prevladujoča

## **8. Opišite proces staranja elementov s pomočjo opisa degradacijskih procesov.**

### **Podajte primer procesa staranja – degradacija CF upora - difuzijski proces.**

#### Staranje

- Počasno spreminjanje strukture elementa, zaradi degradacijskih procesov, med dolgoletnim delovanjem.

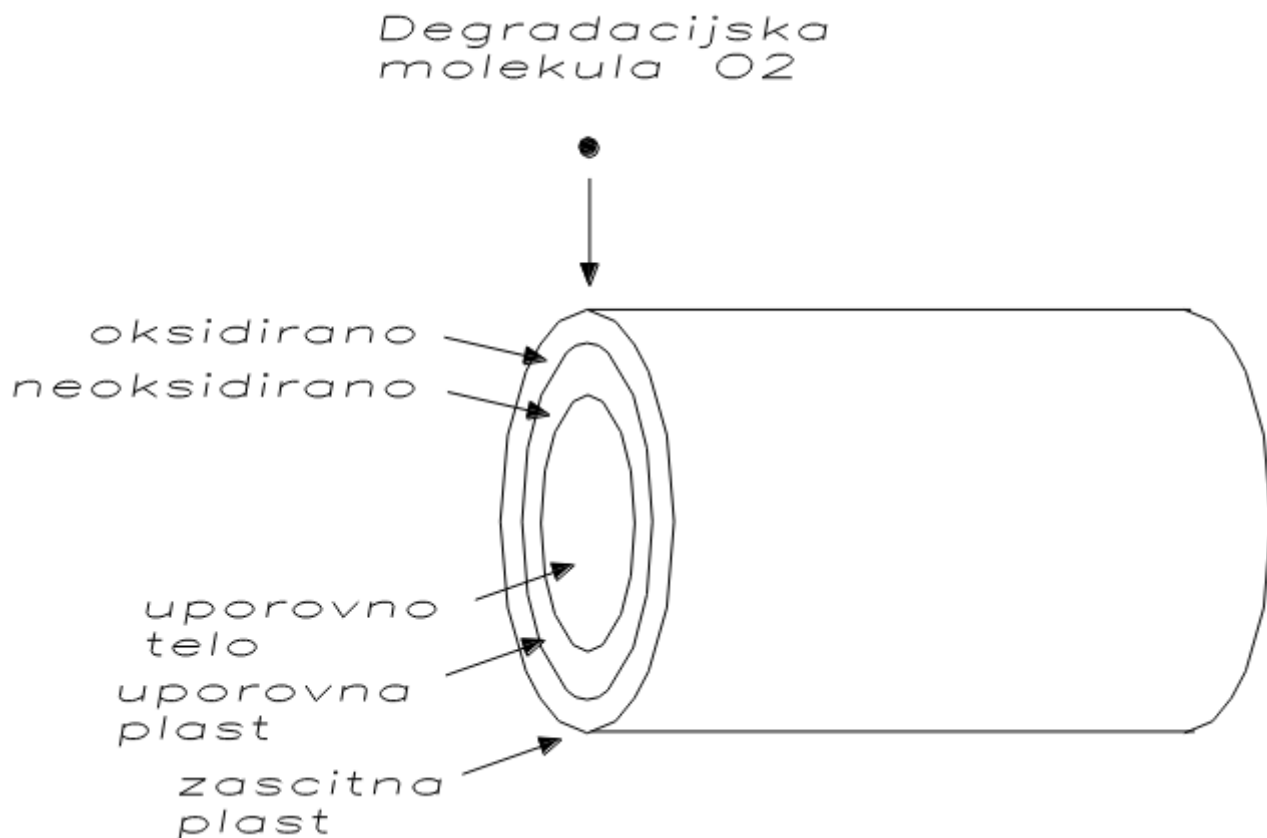
#### Opis degradacijskih procesov

- Degradacijski procesi so škodljivi, počasni fizikalni ali kemijski procesi, ki potekajo v elementu kot posledica vplivov iz okolice ali iz elementa samega.
- Primer:
  - kemijske reakcije zaradi prisotnih agresivnih snovi (korozijske metalizacijske linije v PCB/IC)
  - mehanske razpoke v strukturi zaradi temperaturnih šokov pri segrevanju in ohlajanju elementa

#### Degradacija CF upora - difuzija

- Molekule  $O_2$  iz okolice zaradi povišane temperature v obremenjenem uporu tekom let počasi difundirajo v globino strukture.
- Molekula  $O_2$  prodre do uporabne plasti,
- Plast oksidira  $\implies$  uporabni material se spremeni v izolator.

- Znan tak primer je degradacija CF upora, kjer pri oksidaciji uporovne plasti nastaja  $CO_2$ :



Temperaturna in časovna odvisnost degradacije

- Degradirano področje je določeno, s povprečno globino difuzijskega vdora  $L$  degradacijske molekule ( $O_2$ ) v strukturo elementa.
- Pri difuziji je povprečna globina vdora  $L$  podana z enačbo

$$L = \sqrt{Dt}$$

$t \implies$  čas degradacijskega procesa (leta)

$D \implies$  difuzijska konstanta molekule  $O_2$  v CF uporu

Difuzija

- Difuzija je izmenjevalno preskakovanje atomov po kristalni rešetki zaradi termičnega gibanja atomov
- Difuzijska konstanta raste s temperaturo, kot opisuje Arrheniusova temperaturna odvisnost

$$D = D_{\infty} e^{-\frac{E_{aD}}{kT}}$$

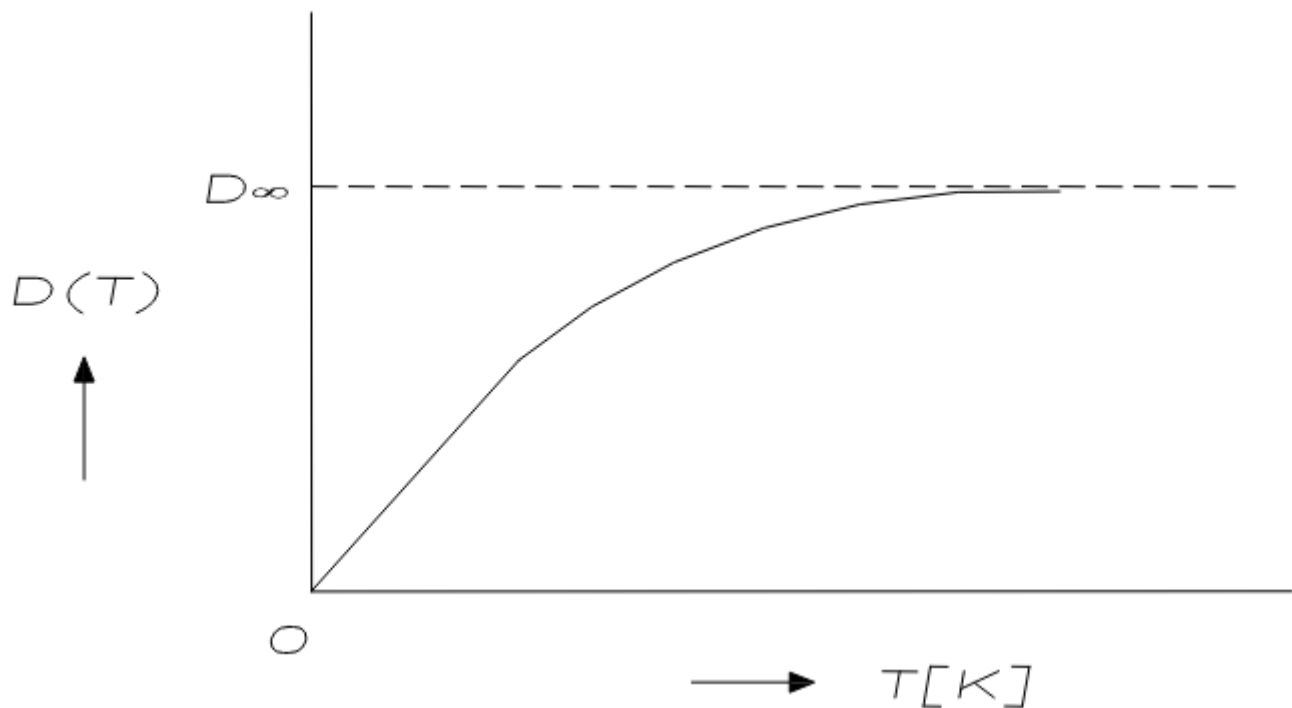
$D_{\infty} \implies$  limitna vrednost  $D$  za visoke temperature

$E_{aD} \implies$  aktivacijska energija difuzijskega procesa  $E_{aD} \approx 1.2 eV$

$k \implies$  Boltzmannova konstanta  $k = 8.6 * 10^{-5} eV/K$

$T \implies$  absolutna temperatura v  $K$





Degradacija CF upora

- Uporovna plast se med dolgoletnim procesom staranja stalno tanjša
- Upornost upora  $R(t)$  s časom stalno raste.
- Tako spremembo upornosti imenujemo degradacija upora  $\Delta R$ .
- Ko  $R(t)$  preseže od proizvajalca predpisano maksimalno dopustno vrednost upornosti  $R_{max}$  ga je potrebno zamenjati z novim.
- To je odpoved elementa

$$R(t) \geq \Delta R_{max} = R_{max} - R_0$$

Degradacija CF upora

$$L = \sqrt{Dt} = \sqrt{D_{\infty} e^{-\frac{E_a D}{kT}} t}$$

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

## 9. Pospešeno staranje in testiranje: Kje se uporablja?

**Kako poteka pospešeno staranje s povišano temperaturo na primeru CF upora?**

Pospešeno staranje in testiranje

- Staranje lahko pospešimo z intenziviranjem različnih parametrov, ki pospešujejo degradacijske procese
- Proces intenziviranja takega parametra imenujemo obremenitev (stress), posledico tega imenujemo pospešeno staranje

## Uporaba pospešenega staranja

- S pospešenim staranjem povzročijo visoko odpoved v tovarni.
- Tisti, ki preživijo, so preživeli obdobje otroške umrljivosti
- Slabi elementi odpovedo že v tovarni in jih izločijo, na tržišče pridejo dobri elementi z višjo zanesljivostjo.
- Pospešeno staranje se uporablja za:
  - določitev življenjskih časov elementov (MTTF, FIT)
  - določitev aktivacijske energije ( $E_a$ ) degradacije

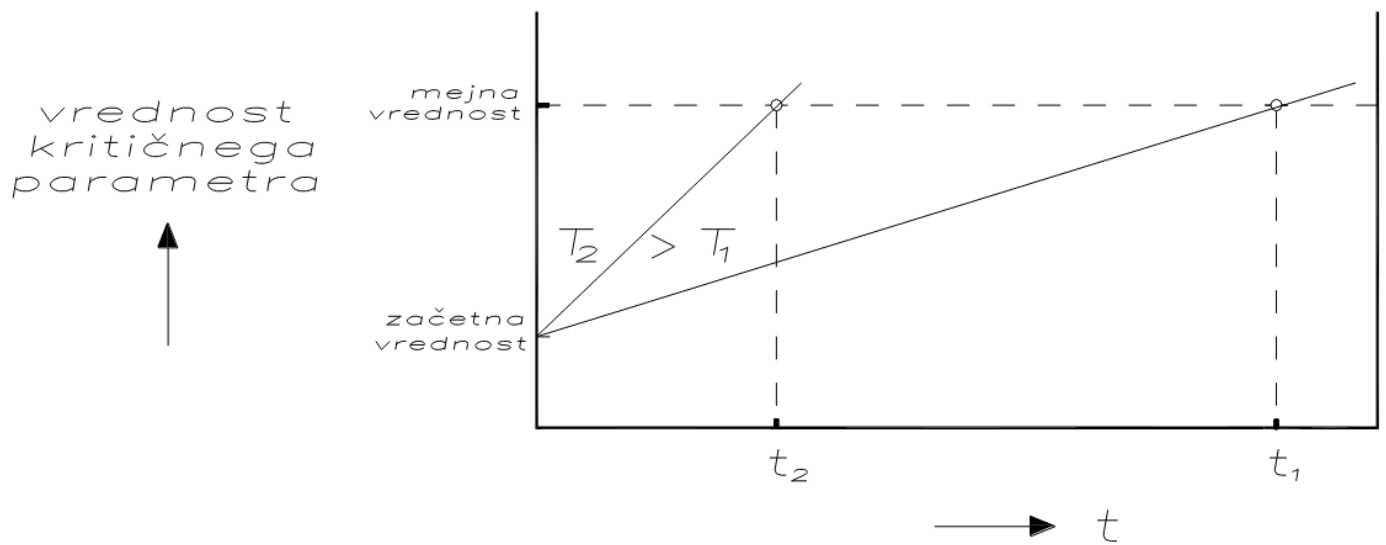
## Pospešeno staranje s povišano temperaturo

- Hitrost degradacije je določena s hitrostjo degradacijske reakcije (Reaction Rate, RR)
- Pri degradaciji CF upora  $\implies$  hitrost oksidacije uporovne plasti
- RR je pri oksidaciji uporovne lasti določena z globino vdora L in časom
- Zato ima RR običajno enako temperaturno odvisnost kot L:

$$RR(T) = RR_{\infty} e^{-\frac{E_a D}{kT}}$$

## Pospešeno staranje CF upora

- Meritev  $R(t)$  pri različnih temperaturah:.
- Dobimo rezultat meritve pri temperaturah ( $T_2 > T_1$ )
- Zaradi degradacije  $R(t)$  raste  $\implies$  element odpove,  $R(t) = R_{max}$ .
- Če dvignemo temperaturo meritve  $T_2 > T_1$  potekajo degradacijske reakcije hitreje in degradacija narašča bolj strmo
- Hitrejša odpoved elementa pri višjih temperaturah ( $t_{odp2} < t_{odp1}$ ) oz. pospešeno staranje elementa
- Večja, ko je hitrost reakcije  $RR$  pri temperaturi  $T$  krajši je čas do odpovedi pri tej temperaturi  $t_{odp}(T)$



$$RR(T) = RR_{\infty} e^{-\frac{E_a D}{kT}}$$

$$\frac{t_{odp1}}{t_{odp2}} = \frac{RR_2}{RR_1} = e^{\frac{E_a}{k} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$$

###### 10. Pospešitveni faktor:

Kaj je pospešitveni faktor  $AF_x$ , kateri parametri staranja  $x$  obstajajo?

Podajte primer pospešenega staranja s temperaturo  $AF_T$ ?

Kako opišemo staranje pri kombiniranem spreminjanju več parametrov?

Pospešitveni faktor (acceleration factor  $AF_x$ )

- Pospešitveni faktor zaradi povišane temperature  $AF_T$  je razmerje  $RR$  pri temperaturah ( $T_2 > T_1$ )
- Za kolikokrat pospešimo degradacijski proces, če dvignemo temperaturo iz  $T_1$  na  $T_2$

Pospešitveni faktor  $AF_T$  - primer

- Določi pospešitveni faktor  $AF_T$  pri pospešenem staranju s podatki:
- $E_a = 1\text{eV}, T_1 = 50^\circ\text{C}$
- Temperatura pospešenega staranja  $T_2 = 125^\circ\text{C}$  !

$$T_2 = 398\text{K}, T_1 = 323\text{K}$$

$$AF_T = \frac{t_{odp1}}{t_{odp2}} = \frac{RR_2}{RR_1} = e^{\frac{E_a}{k} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)} \approx 300$$

###### 11. Na primeru prikažite postopek določanja FIT/MTTF in aktivacijske energije $E_a$ ?

Določanje FIT/MTTF in  $E_a$

- Življenjski čas je povprečni čas, ki ga element ali sistem preživi od začetka svojega delovanja do odpovedi.

- Eksperimentalno ugotavljanje pri sobni temperaturi trajalo predolgo MTTF , saj tipične življenjske dobe znašajo 10 in več let, posameznih elementov pa še mnogo dalj!
- Zato degradacijo oz. staranje skušamo pospešiti z intenziviranjem nekega parametra, ki pospešuje degradacijske procese ter tako skrajšamo življenjske čase in s tem čas meritev

#### Določanje MTTF - primer

- Element uporabljamo na  $125^{\circ}C$
- Element ima eksponentni potek funkcije zanesljivosti ( $R(t) = \exp(-\lambda t)$ )
- $MTTF \approx 4500$  ur.
- Normalna uporaba komponente je pri sobni temperaturi ( $T \approx 25^{\circ}C$ )
- Kakšna je funkcija odpovedi ( $FR$ )?
- Koliko % elementov bo odpovedalo pred predvidenim življenjskim časom (40000 ur), če je  $AF_T \approx 35$  za podani temperaturi?

$$MTTF(T = 125^{\circ}C) = 4500h$$

$$AF_T = e^{\frac{E_a}{k}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})} \approx 35$$

$$MTTF(T = 25^{\circ}C) = 4500h \cdot 35 = 157500h$$

$$FR = \lambda = \frac{1}{MTTF(25^{\circ}C)} = \frac{1}{157500h}$$

$$F(t) = 1 - R(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

$$F(40000h) = 1 - R(40000h) = (1 - e^{\lambda \cdot 40000h}) \cdot 100\% = 22.43\%$$

## 12. Kako razdelimo upore?

Razdelitev uporov in njihove značilnosti

- Linearni upori
  - Plastni upori (CF, MF)
  - Žični upori
  - Specialni upori
- Nastavljivi upori
  - Nelinearni upori
  - NTC termistorji
  - PTC termistorji
  - Varistorji

### 13. Osnovne značilnosti uporov ( $R_n$ , lestvice, $TK_R$ , $R_C$ , UM, $\Delta R/R$ )

Kupljeni upor ima kataloške podatke:  $R_n = 10k\Omega$ , toleranca uporovne družine je  $\pm 10\%$ .

Kakšno izmerjeno upornost  $R$  upora lahko pričakujemo?

Kaj je nazivna (ang. nominal) upornost  $R_n$ ?

Kaj je dobra tehnologija izdelave uporov glede na izplen?

Osnovne značilnosti uporov

- Nazivna upornost ( $R_n$ )
  - Pričakovana vrednost upornosti danega upora, ki se od dejanske upornosti upora  $R$  ne sme razlikovati več kot je toleranca uporovne družine ( $\Delta R$ ).
- Toleranca (lestvice)
  - Toleranca ( $\Delta R$ ) je največje relativno odstopanje izmerjene upornosti  $R$  od nazivne upornosti  $R_n$
- Temperaturni koeficient upornosti ( $TK_R$ )
- Kritična upornost  $R_c$
- Mejna napetost  $U_L$
- Degradacija po času delovanja ( $\Delta R/R$ )

Kupljeni upor ima kataloške podatke:  $R_n = 10 k\Omega$ , toleranca uporovne družine je  $\pm 10\%$ .

Kakšno izmerjeno upornost  $R$  upora lahko pričakujemo?

Rešitev:

$$\text{Toleranca } \frac{\Delta R}{R_n} = \frac{(R - R_n)}{R_n} = 10\% = 0.10$$

Največje odstopanje izmerjene upornosti je:  $\Delta R = \pm 0.10 * R_n = \pm 1k\Omega$

$$R = [9...11k\Omega]$$

Kaj je dobra tehnologija izdelave?

- Pri dobri tehnologiji odstopanje izmerjenih upornosti Gaussovo porazdelitev okrog želenih nazivnih vrednosti  $R_n$
- Pri dobri tehnologiji je največ izdelanih uporov v bližini želene vrednosti, z oddaljenostjo od te vrednosti pa število uporov upada.

### 14. Kaj je Renardova lestvica in kaj so tolerančni razredi?

Kakšna je porazdelitev uporov znotraj tolerančnega razreda pri dobri tehnologiji izdelave?

Zakaj nimamo vrednosti dekade uporov porazdeljene linearno ... 1 k $\Omega$  , 2 k $\Omega$  , 3 k $\Omega$  ...?

Podajte formulo za izračun člena zaporedja v dekadi Renardove lestvice.

Izračunajte vrednosti dekade E12 lestvice.

Katere so preostale Renardove lestvice in kolikšne so njihove tolerance?

Kje vse se še uporabljajo Renardove lestvice?

## Renardove lestvice

- Ali je mogoč tak izbor nazivnih vrednosti, da bi bile vse upornosti v najslabšem primeru približane z enako toleranco?
- Da, če so nazivne vrednosti členi nekega **geometričnega zaporedja**.
- Takemu izboru nazivnih vrednosti rečemo **Renardova lestvica**.
- $n$ -ti člen določen z izrazom:

$$N_n = a \cdot r^{n-1}$$

$n \Rightarrow$  indeks geometričnega zaporedja (1, 2, 3...)

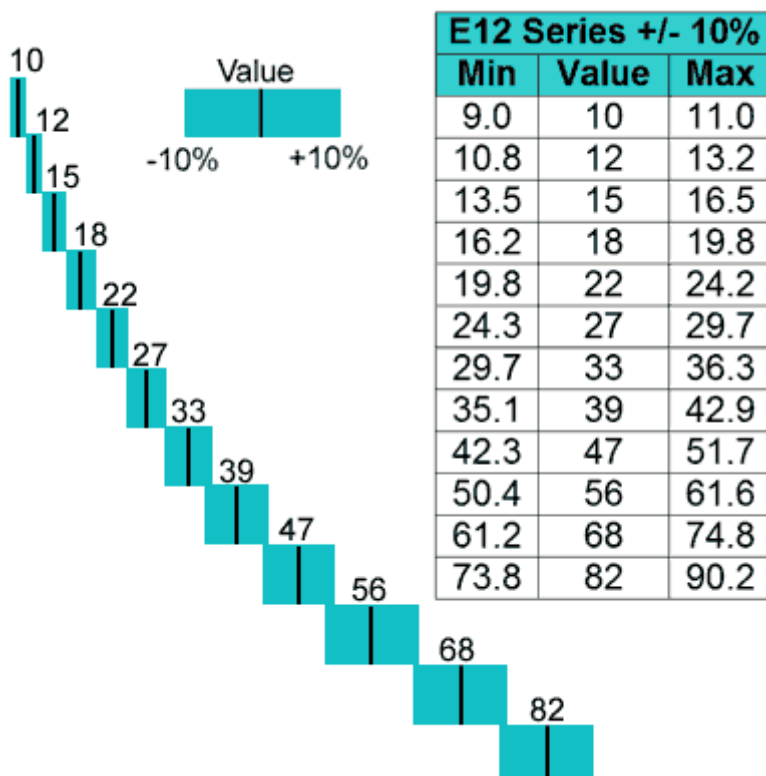
$a \Rightarrow$  prvi člen zaporedja ( $n = 1$ )

$r \Rightarrow$  razmerje geometričnega zaporedja ( $r = \frac{N_{n+1}}{N_n}$ )

- Če bi proizvajalec določil vrednosti linearno: ... , 1k $\Omega$  , 2k $\Omega$  , 3k $\Omega$  ... 99k $\Omega$  , 100k $\Omega$  , 101k $\Omega$  , ...
  - visoke upornosti  $R \approx 100\text{k}\Omega$  so zelo dobro približane
  - nizke upornosti  $R \approx 1\text{k}\Omega$  so zelo slabo približane, v najslabšem primeru na 50% natančno
- Tak izbor nazivnih vrednosti **ni primeren**, saj so lastnosti električnega vezja določene z največjim **relativnim odstopanjem** elementov od nazivnih vrednosti v vezju

## Renardova lestvica E12

- Maksimalna odstopanja oz. tolerančni razredi so konstantni ( $\pm 10\%$ ) po vsej lestvici!  
 $E12 \Rightarrow$  Renardova lestvica s toleranco 10%



## Ostale Renardove lestivce

Renardova lestvica	čenov / dekad	toleranca
E12	12	10%
E24	24	5%
E48	48	2%
E96	96	1%
E192	192	0.5%

Renardove lestvice se uporabljajo pri izboru nazivnih vrednosti:  $R$ ,  $C$ ,  $U_{ZENER}$

Renardove lestvice se uporabljajo tudi pri drugih izdelkih, dolžina žebnja, velikost vinskih sodov...

Oznaka uporov z barvno kodo IEC – iz podane tabele barv razberite vrednost upora?

Katero vrednost ima upor z enim samim črnim kolobarjem?

Zakaj ga uporabljamo?

Kako označujemo močnejše upore s številčno kodo IEC?

Kaj je R oz. E v številčni oznaki upora?

Kaj pomenijo pripone K, M – zapišite vrednost 1.7 k upora 5 W kot bi jo razbrali na ohišju upora).

**15. Oznaka uporov z barvno kodo IEC – iz podane tabele barv razberite vrednost upora?**

**Katero vrednost ima upor z enim samim črnim kolobarjem?**

**Zakaj ga uporabljamo?**

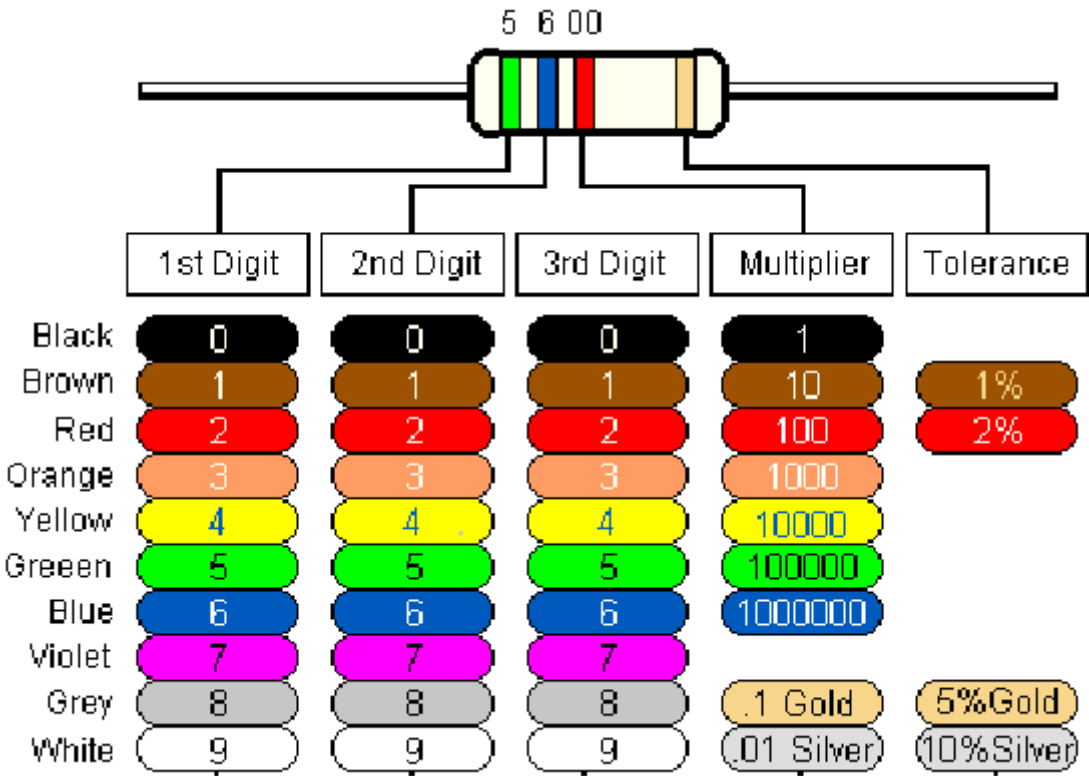
**Kako označujemo močnejše upore s številčno kodo IEC?**

**Kaj je R oz. E v številčni oznaki upora?**

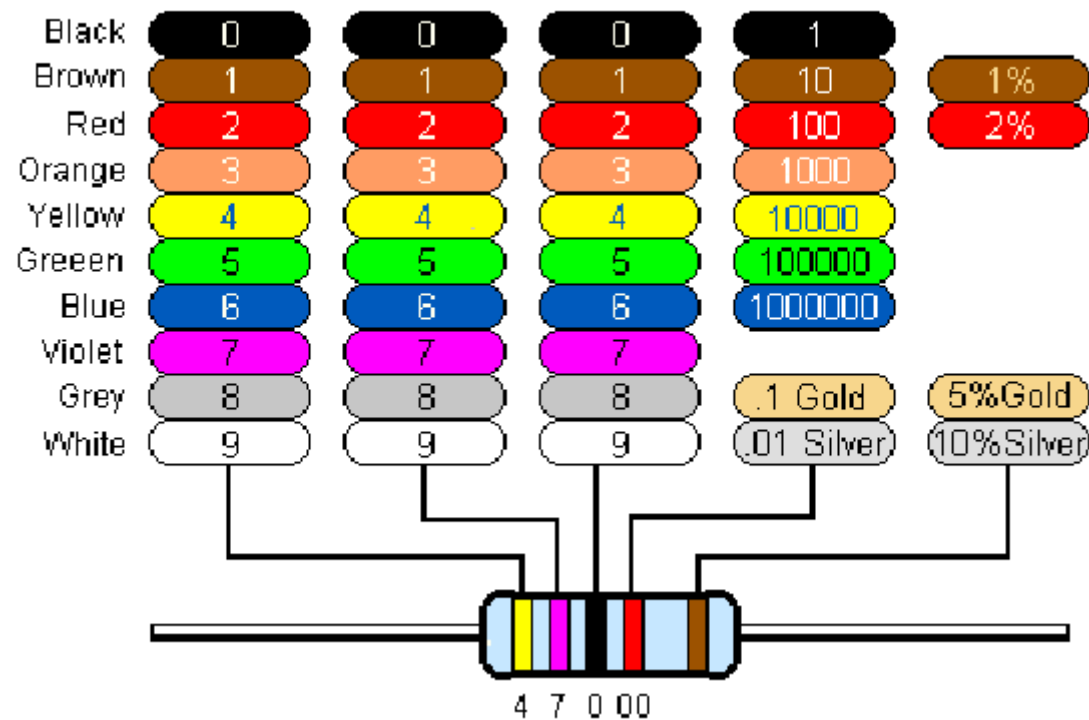
**Kaj pomenijo pripone K, M – zapišite vrednost 1.7 k upora 5 W kot bi jo razbrali na ohišju upora).**

En sam črn kolobar (kratkostičnik, zero-ohm resistor): Uporablja se za premostitev (žica). Zaradi strojev za polaganje komponent – žico je stroju težje položiti kot standardni upor.

IEC iz 4 kolobarjev

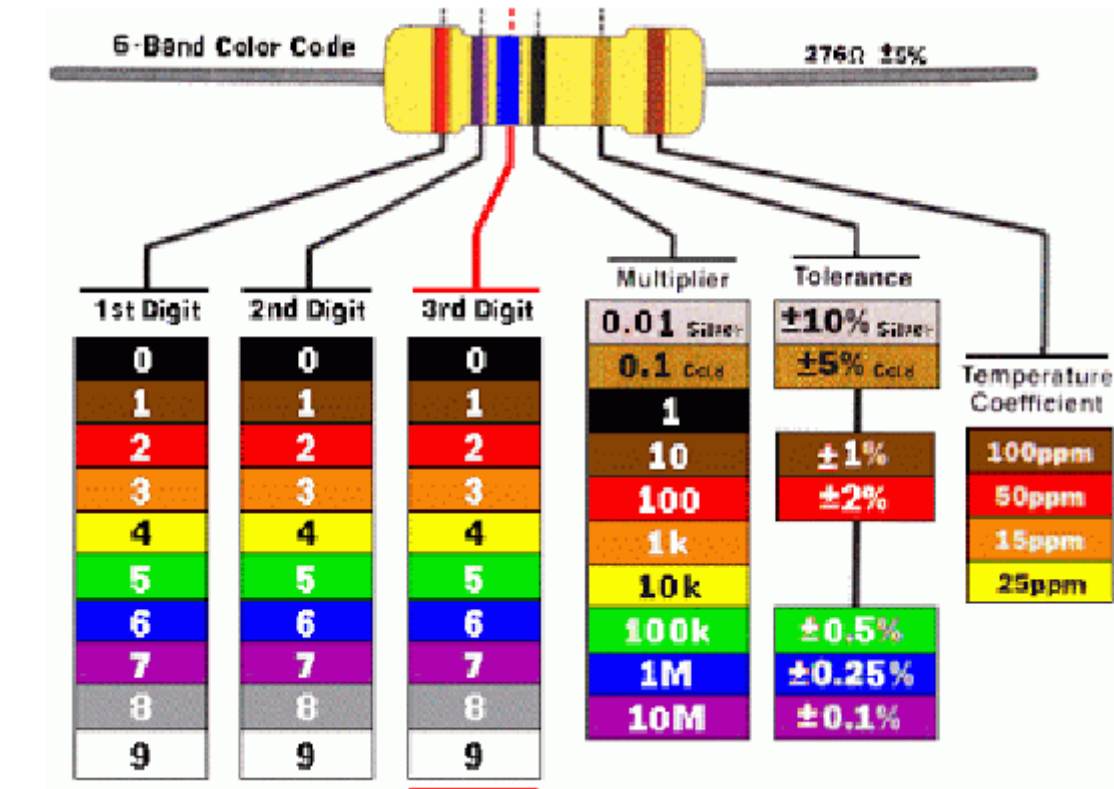


IEC iz 5 kolobarjev





IEC iz 6 kolobarjev



16. Katere vrste IEC označevanja SMD uporov poznate?

Iz podane vrednosti upora razberite vrednost SMD upora.

Razložite troštevilično oznako po IEC sistemu označevanja SMD uporov.

Razložite primer, če oznako sestavljata številki in črka (tabela vrednosti števil in črk je podana spodaj)

IEC označevanje SMD uporov

- SMD upori (0603 ali 0805)
- Na uporu so trije/štirje znaki (številke/črke)
- Če so vsi trije znaki številke, gre zelo verjetno za E24 lestvico.
- Način označevanja je podoben označevanju s kolobarji:

Prvi številki  $\implies$  števki vrednosti,

3.  $\implies$  multiplikator

E96 lestvica za označevanje SMD uporov

Številki/črka:

- Številki  $\implies$  prve tri števke vrednosti
- Črka  $\implies$  multiplikator

Črka	multiplikator	Črka	multiplikator	Črka	multiplikator
Z	1m	A	1	D	1K

Črka	multiplikator	Črka	multiplikator	Črka	multiplikator
Y/R	10m	B/H	10	E	10K
X/S	100m	C	100	F	100K

Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

17. Podajte definicijo  $P_n$  in  $T_{MAX}$  elementa?

Kaj predstavlja termična upornost  $R_{thSA}$ ?

Kolikšne so tipične vrednosti  $R_{thSA}$ ?

Ali se z dodatkom hladilnega telesa upor  $R_{thSA}$  zmanjša ali poveča?

Nazivna moč (ang. nominal power)  $P_n$

- Nazivna moč maksimalna dopustna moč, maksimalna moč segrevanja (ang. maximal power dissipation)  $P_n$  je maksimalna dopustna moč električne obremenitve, ki jo upor še prenese brez degradacije!
- $P > P_n \implies$  Telementa  $> T_{max} \implies$  degradacija oz. uničenje elementa.
- Maksimalna temperatura  $T_{max}$  je najvišja temperatura, ki jo materiali v elementu še prenesejo brez degradacije.
- $T_{max}$  (navadni upori)  $\approx 150^\circ C$
- $T_{max}$  (močnostni upori)  $\geq 250^\circ C$

Termična upornost  $R_{thSA}$

- $R_{thSA} \implies$  termična upornost (ang. thermal resistance) med tema točkama površina, okolica (surface, ambient)

- $R_{th} \Rightarrow$  mera za učinkovitost odvajanja toplote v okolico.
- Enota  $R_{th} \Rightarrow [^{\circ}C/W]$
- Koliko W element oddaja v okolico pri razliki temperatur ( $T_S - T_A = 1^{\circ}C$ ).
- $T_A$  ni enaka sobni ( $T_{sobna} \approx 25^{\circ}C$ ), saj so elementi v ohišju
- Tipične vrednosti  $T_A \approx [50...90^{\circ}C]$

$$P_{odd} = \frac{T_s - T_a}{R_{thSA}}$$

V termičnem ravnovesju velja

$$P_{segr} = P_{odd} = \frac{T_s - T_a}{R_{thSA}}$$

**18. Opišite analogijo med elektrotehničnimi in termičnimi problemi?**

**Kaj je termično ravnovesje?**

**Ali moč na elementu lahko povečamo preko vrednosti  $P_n$ ?**

**Kaj je "Power derating curve"  $P_n(T_A)$ ?**

**Narišite jo in razložite mejne točke ( $T_{MAX}$ ,  $P_{n70}$ ).**

**Kakšne so vrednosti  $T_{MAX}$  za tipičen 1W CF upor in kakšne za 7 W MF upor?**

**Kako iz velikosti SMD upora (0402, 0603, in 0805 ocenimo njegovo  $P_n$ )?**

Analogija med elektrotehničnimi in termičnimi problemi

- Enačba za oddajanje toplote je termična analogija Ohmovega zakona:
- toplotna moč P/električni tok I, ki teče med dvema točkama (s,a) po toplotnem ali električnem vodniku,
- je proporcionalen temperaturni/potencialni razliki med točkama ( $T_s - T_a$  oz.  $V_s - V_a$ )
- in obratno sorazmeren termični/ohmski upornosti  $R_{thsa}/R_{sa}$  med točkama (s, a)

Termično ravnovesje

- Vklon  $\Rightarrow P_{segr} = UI \Rightarrow$  element se segreva
- $T_S$  raste  $\Rightarrow$  raste oddajanje toplote
- Ko  $T_S$  naraste, da postane:

$$P_{odd} = P_{segr} = U \cdot I$$

oddana moč = prejeti moči segrevanja

- $T_S$  se stabilizira:  
( $T_S = const$ )  $\Rightarrow$  termično ravnovesje
- V termičnem ravnovesju velja:

$$P_{segr} = P_{odd} = \frac{T_s - T_a}{R_{thsa}}$$

- Na uporju je napetost  $U = 5V$  in skozenj teče tok  $I = 1A$ .
- Termična upornost elementa znaša  $R_{THSA} = 10^\circ C/W$ .
- $T_A \approx 70^\circ C$
- $T_S = ?$

$$T_S = T_a + R_{thsa} P_{segr} = 70^\circ C + 10^\circ C = 120^\circ C$$

Nazivna moč upora  $P_n$

- Nazivna moč je tista moč segrevanja, pri kateri element ravno doseže maksimalno dopustno temperaturo ( $T_S = T_{MAX}$ )

$$P_n = \frac{T_{max} - T_a}{R_{thsa}}$$

Povečanje  $P_n$

- če povišamo  $T_{MAX}$  (temperaturno odpornejši materiali omogočajo višje delovne temperature  $\implies$  večje odvajanje moči)
- znižamo  $T_A$  (večja temperaturna razlika  $\implies$  večje odvajanje sproščane moči)
- znižamo  $R_{THSA}$  (boljše odvajanje toplote)
- $P_n = P_n(T_A)$
- Pri podatku  $P_n$  je vedno podana  $T_A$ !  
 $T_A \approx 70^\circ C$

$P_n(T_A) \implies$  Power derating curve

- $P_n = P_n(T_A)$  ( $T_A$  je stvar aplikacije)
- Pri drugačnih  $T_A$  se lahko  $P_n$  zmanjša oz. poveča (črtna črta).
- Meja: Zaradi varnosti  $P_n$  ne dopustijo povečevati  $T_{Amin} = 70^\circ C$  (polna črta)

Moč na SMD uporih ocenimo iz njihove velikosti:

0402, 0603  $\implies$  1/16W ... 1/10W

0805  $\implies$  1/10W ... 1/8W

**19. Kaj je kritična upornost  $R_c$  oz. z njo povezana mejna napetost  $U_m$ ?**

**Narišite tipičen potek  $U(R)$  in označite točki  $R_c$  ter  $U_m$ .**

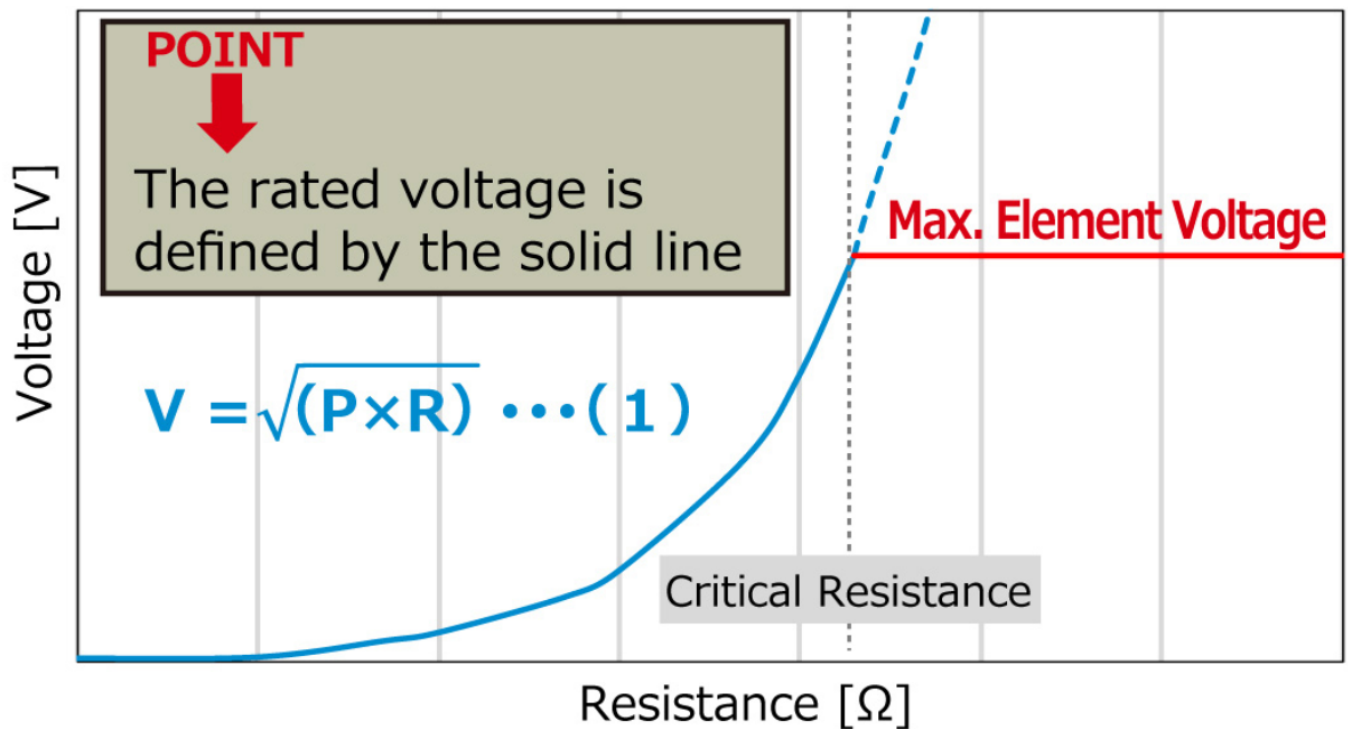
**Razložite mejo med dvema deloma karakteristike in vpliv, ki prevladuje v posameznem delu karakteristike.**

### Kritična upornost $R_c$

- Če upor segrevamo z nazivno močjo  $P_n$ , potem termične omejitve določajo koliko sme biti največja nazivna upornost  $R_n$
- To velja predvsem za nizke upornosti do kritične upornosti  $R_c$ , kjer se pojavi nazivna (ang. nominal) napetost  $U_n$ , ki jo upor še prenese brez degradacije.

$$P_n = U_n \cdot I_n = \frac{U_n^2}{R_n} = I_n^2 \cdot R_n$$

$$U_n = \sqrt{P_n \cdot R_n}$$



### Mejna napetost $U_L$

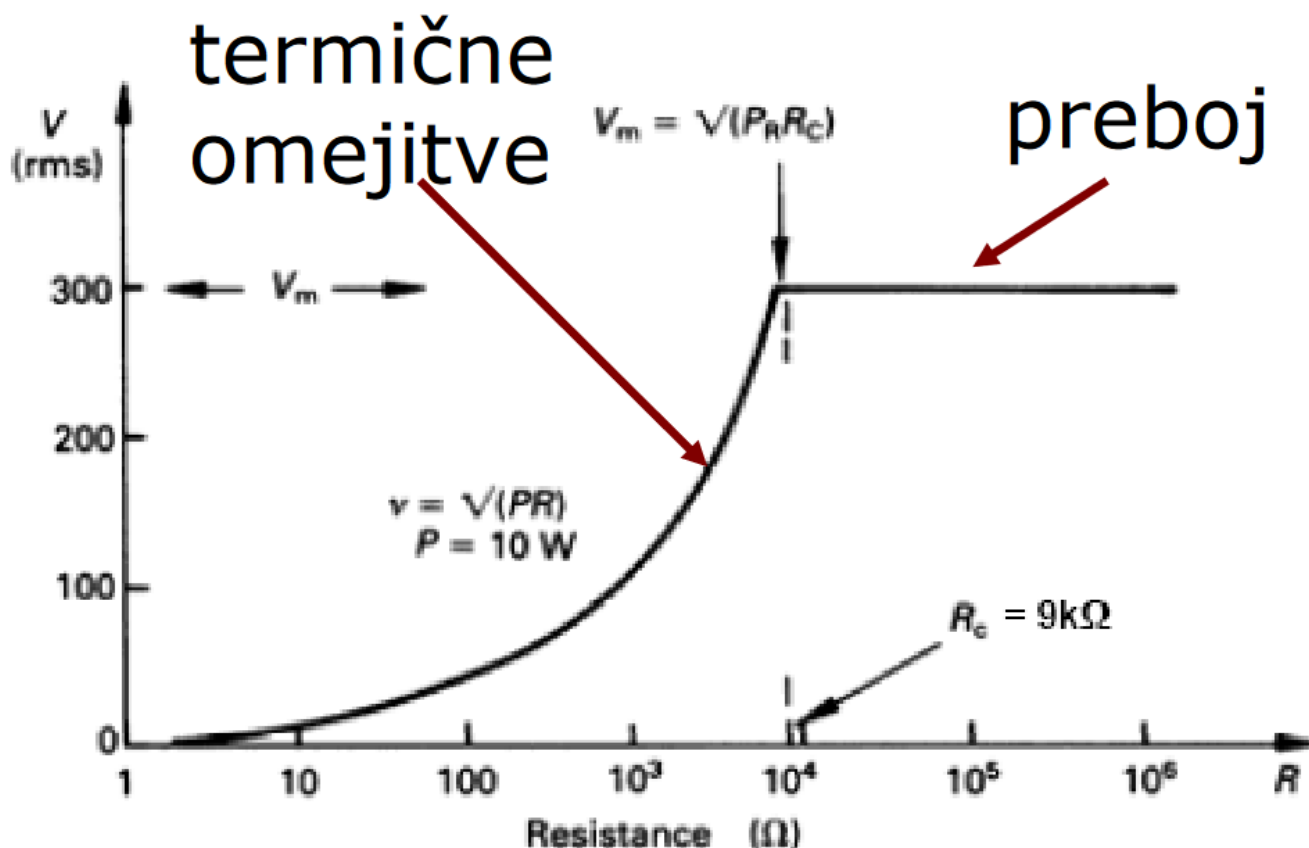
- Pri visokih upornostih ( $R \approx 1M\Omega$ ) nad  $R_c$  je maksimalna dopustna napetost določena s prebojnimi omejitvami
- $U_L \Rightarrow$  maksimalna napetost, ki jo upor še prenese brez preboja; mejna (ang. limit) napetost.
- Namesto  $U_L$  se včasih poda  $R_c$ , pri kateri se zgodi za dano družino uporov **prehod od termičnih omejitev na prebojne**.

$$U_n = \sqrt{P_n R_n} = \sqrt{1W \cdot 100M\Omega}$$

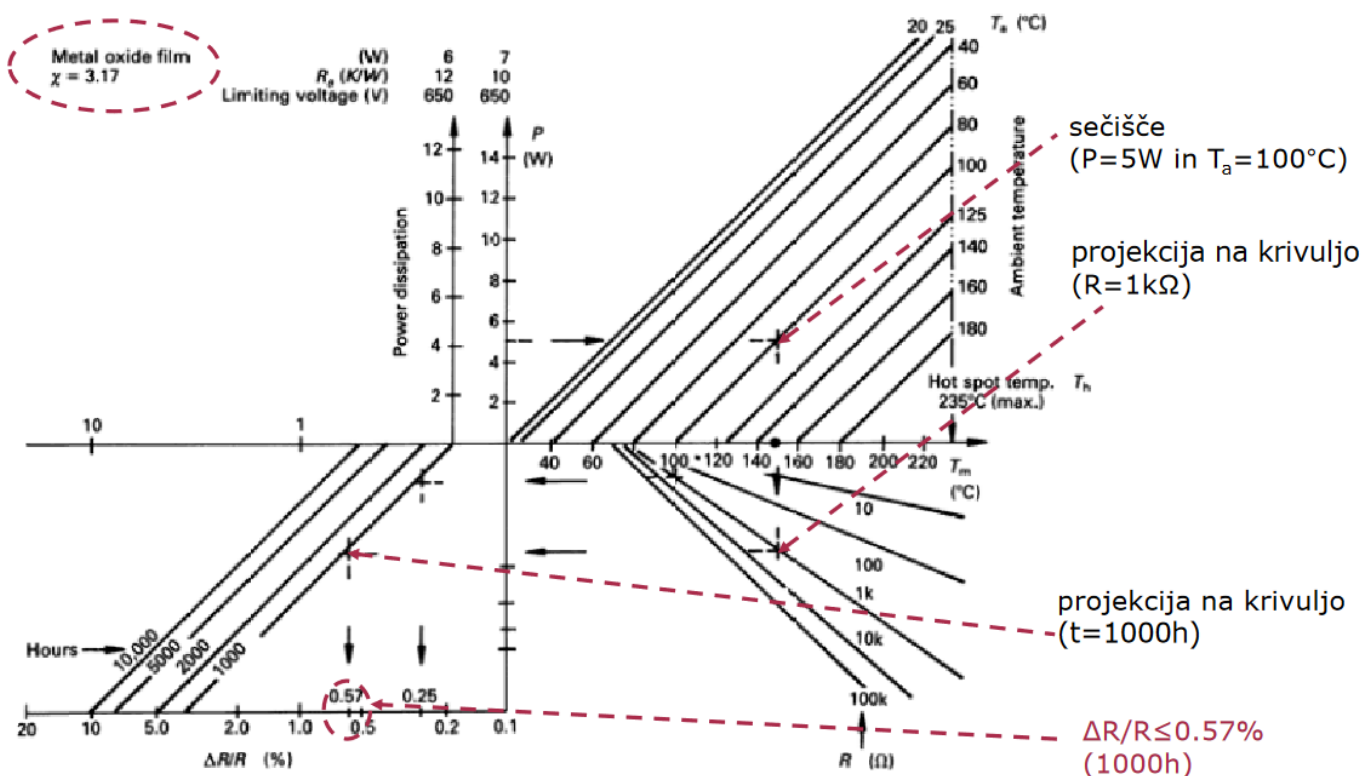
*Preboj!*

$$U_n = \sqrt{P_n R_n} \quad R_n < R_c \quad \text{segrevanje}$$

$$U_n = \sqrt{P_n R_n} \quad R_n \geq R_c \quad \text{preboj}$$



20. Kako je definirana nestabilnost uporov  $\Delta R/R$  po poljubnem času delovanja?  
 Na podanem nomogramu upornosti prikažite postopek določanja  $\Delta R/R$  za ( $T_A = 100^\circ \text{C}$ ,  $P = 5 \text{ W}$ ) po 1000 urah?



Nestabilnost uporov

- Nestabilnost elementa (degradacija ali staranje elementa) podaja spremembo lastnosti elementa po dolgotrajnem delovanju  $R_0$ :

$$\left. \frac{\Delta R}{R} \right|_t = \frac{R_t - R_0}{R_0}$$

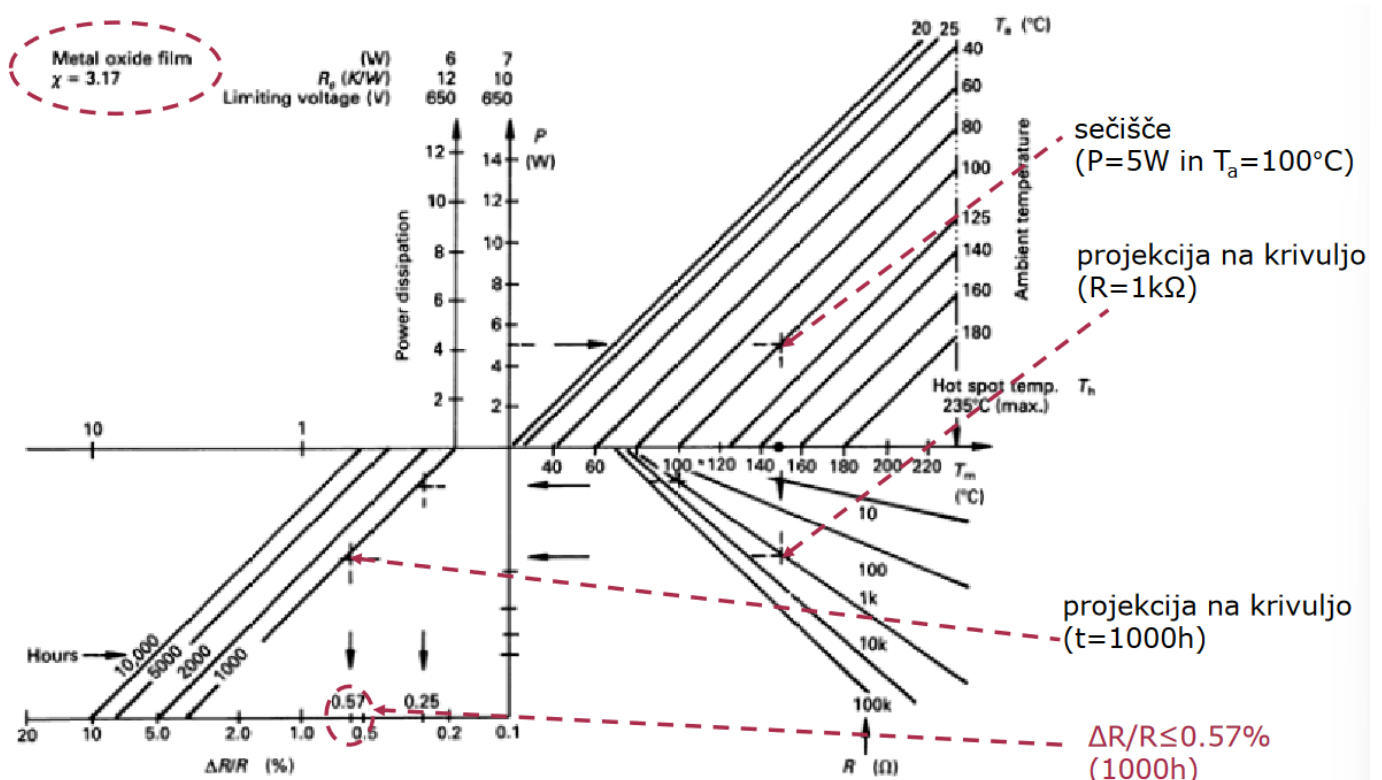
- $R_t \implies$  spremenjena upornost po dolgotrajnem delovanju  $t$ ,
- $R_0 \implies$  začetna upornost upora ob izdelavi.

### Nomogram upornosti - nestabilnost uporov

- Nestabilnost uporovnih družin je podana grafično z **nomogramom** (večparametrski diagram):
- Podajanje izmerjene relativne spremembe upornosti  $\Delta R/R$ :
  - pri električnih obremenitvah
  - povišanih temperaturah upora  $T_s$ , po daljšem času delovanja (standard je 1000 h)

$\Delta R/R (T_a = 100^\circ C, P = 5W)$  po 1000 urah?

- Na MF uporu  $1k\Omega$ ,  $5W$  se porablja moč  $5W$
- Iz nomograma določite ( $T_{amax} = 100^\circ C$ ):
  - Stabilnost upora pri ( $T_a = 100^\circ C$ ) po 1000 urah vnačinu pripravljenosti (stand-by)  $\implies (P = 0W)$
  - Temperaturo upora, ko se na njem porablja  $5W$
  - Spremembo upornosti po  $10^3$  in  $10^5 h$  delovanja.



21. Impulzno krmiljenje upora: Kdaj lahko trenutne vrednosti moči trenutno presežejo  $P_n$ ?  
Kakšen kriterij za  $P_M$  velja pri krmiljenju s periodičnimi pulzi?



**Narišite odvisnost impulzne moči od širine pulza na uporu – označite limitni primer?**

**Katerih vrednosti pri  $P_M$  nikakor ne smemo preseči pri hitrih pulzih?**

Impulzno krmiljenje upora

- Pri obravnavi DC električne obremenitve in termičnih omejitev upora smo določili nazivno moč  $P_n$  (max. moč)@(max. dopustna temperatura  $T_{max}$ )

$$P_n = U_n \cdot I_n = I_n^2 \cdot R_n = \frac{U_n^2}{R_n}$$

Za AC moramo DC vrednosti nadomestiti z efektivnimi.

Prekoračitev  $P_n \implies$  prekoračitev  $T_{max} \implies$  uničenje upora

- Trenutne vrednosti moči lahko kratkotrajno presežejo  $P_n$  in upor "preživi" brez degradacije če povprečna moč impulzov ne presega  $P_n$ .

$$P_{povprečna} \leq P_n \implies T_S < T_{max} \implies \text{degradacije ni.}$$

- Vrsti impulznega krmiljenja:
  - krmiljenje z enkratnim impulzom in
  - krmiljenje s periodičnimi impulzi: Enkratni impulz če je čas med dvema pulzoma dovolj dolg ( $f < 0.5\text{Hz}$ ), da se upor do naslednjega impulza ohladi.
- Impulzno krmiljenje je za obravnavo uporov  $> 1\text{W}$ .

**22. Kaj je temperaturni koeficient upornosti -  $TK_R$  (kaj podaja, definicija)?**

**Če je druga oznaka za  $TK_R = \alpha_R$ , kaj je potem  $\beta_R$ ?**

**Navedite primer materiala za upore, ki ima pozitiven  $TK_R$ .**

Temperaturni koeficient upornosti -  $TK_R$

- Uporovne lastnosti resničnih materialov se spreminjajo s temperaturo  $\implies R = R(T)$
- Temperaturne lastnosti elementov in materialov podajamo s temperaturnimi koeficienti ( $TK$ ,  $TC$  ali  $\alpha$ ).
- Temperaturni koeficient ima ponavadi dodan še indeks, ki podaja veličino, katere temperaturno odvisnost koeficient opisuje: Temperaturni koeficient upornosti  $TK_R$ .
- $TK$  so definirani kot razmerje relativne spremembe opazovane veličine in spremembe temperature.

$$TC_R = \frac{\left(\frac{dR}{R}\right)}{dT} = 1/R \cdot \frac{dR}{dT} = \frac{d(\ln(R))}{dT}$$

$$TC_R = \frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_2 - R_1}{T_2 - T_1} \cdot 10^6 [\text{ppm}/^\circ\text{C}]$$

$R_1$  = upornost pri referenčni temperaturi ( $25^\circ\text{C}$ ) v  $\Omega$

$R_2$  = upornost na temperaturi testiranja ( $-55...155^\circ\text{C}$ ) v  $\Omega$



$T_1 = +25^\circ C$  sobna temperatura

$T_2 = -55^\circ C \dots +155^\circ C$  temperatura testiranja

$$\alpha_R = \left. \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} \right|_{T_0} \quad \text{Naklon krivulje}$$

$$\beta_R = \left. \frac{1}{2R} \frac{d^2 R}{dT^2} \right|_{T_0} \quad \text{Ukrivljenost krivulje}$$

### 23. Kaj je $R_{sh}$ ?

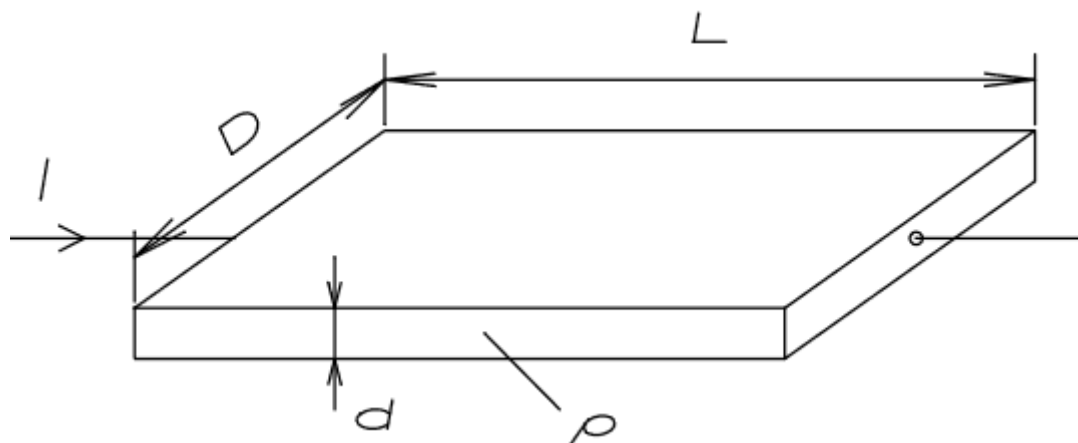
Kako z  $R_{sh}$  izračunamo upornost homogene uporovne plasti?

Kakšna je razlika med  $R_{sh}$  in  $R_{\square}$ ?

Plastna upornost  $R_{sh}$

- Plastni upori: Tanka uporovna plast na substratu (podlagi).
- Upornost plasti  $\implies$  plastna upornost  $R_{sh}$  (ang. sheet resistance).
- $R_{sh}$  merimo hitro, enostavno, natančno in nedestruktivno.
- Uporaba v elektroniki, pri karakterizaciji mikroelektronskih tehnologij in načrtovanju uporov.
- $R_{sh}$ :
  - homogena (lastnosti materiala so v vsaki točki konstantne)
  - nehomogena uporovna plast

Homogena uporovna plast:  $\rho = konst.$



- Uporovna proga:
  - $L \implies$  dolžina,
  - $D \implies$  širina,
  - $d \implies$  debelina,
  - $\rho \implies$  specifična upornost,
  - $I \implies$  tok upora

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = \rho \cdot \frac{L}{D \cdot d} = \left(\frac{\rho}{d}\right) \cdot \left(\frac{L}{D}\right)$$

$$R_{SH} = \frac{\rho}{d}$$

$$R = R_{SH} \cdot \left(\frac{L}{D}\right)$$

Upornost kvadrata -  $R_{\square}$

- Če postavimo  $L = D \implies$  kvadrat  $\implies R_{sh} = R_{\square}$
- plastna upornost je upornost "kvadrata" uporovne plasti

$$R_{\square} = \rho \cdot \frac{L}{A} = \frac{\rho \cdot D}{D \cdot d} = \frac{\rho}{D} = R_{sh}$$

- Enota plastne upornosti je  $[\Omega]$ .
- Enota  $R_{\square}$  je  $[\Omega/\square]$  (ang. ohm-per-square). "Per square"  $\implies$  dimenzija ni pomembna, pomembna je geometrija (kvadrat).

**24. Kako izračunamo upornost nehomogenega materiala (opišite korake postopka)?**

**Zakaj  $R_{sh}$  ne računamo, ampak jo merimo?**

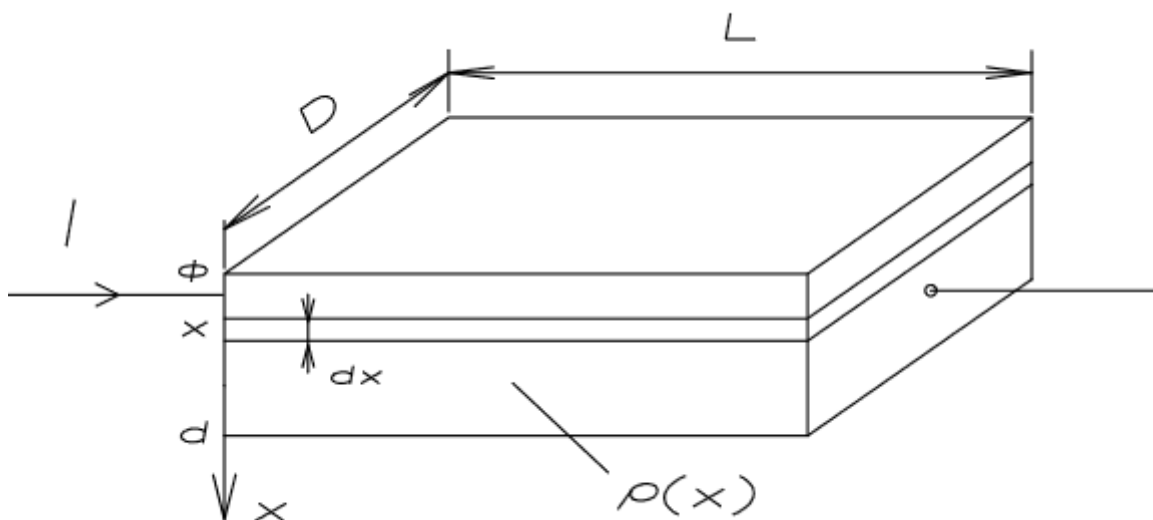
**Opišite osnovno Van der Pauw merilno metodo,**

**Podajte slabosti osnovne meritve in opišite natančnejšo izvedenko te meritve.**

**Narišite eno izmed tipičnih postavitev merilnih kontaktov.**

Nehomogena uporovna plast:  $\rho \neq konst$

- Specifična upornost  $\rho = \rho(x)$
- Specifična prevodnost  $\sigma = \sigma(x)$
- Upor razrežemo na tanke plasti ( $dx$ ), da je specifična prevodnost  $\sigma(dx)$  znotraj plasti  $dx$  konstantna.



$$dG = \sigma(x) \cdot \frac{D \cdot dx}{L}$$

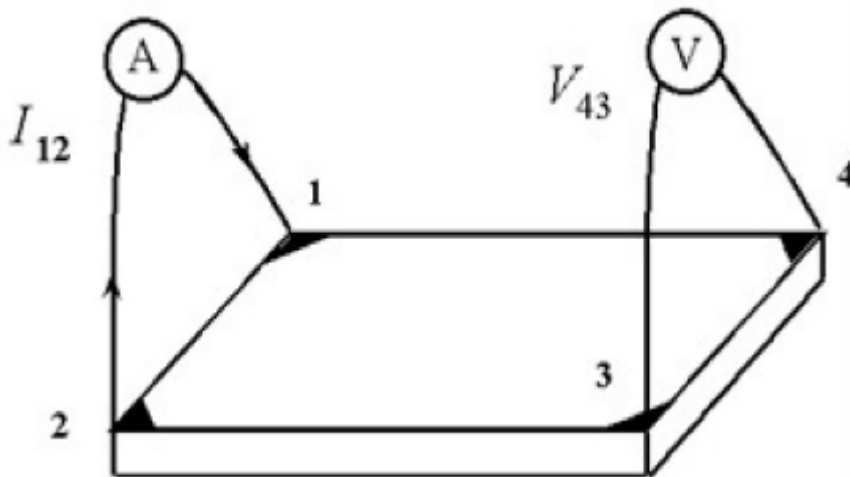
- Celotno prevodnost upora  $G$  dobimo s seštevanjem prevodnosti tankih plasti  $dG$
- $dG$  so vezane vzporedno glede na priključka upora.

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{\int_0^d \sigma(x) dx} \frac{L}{D}$$

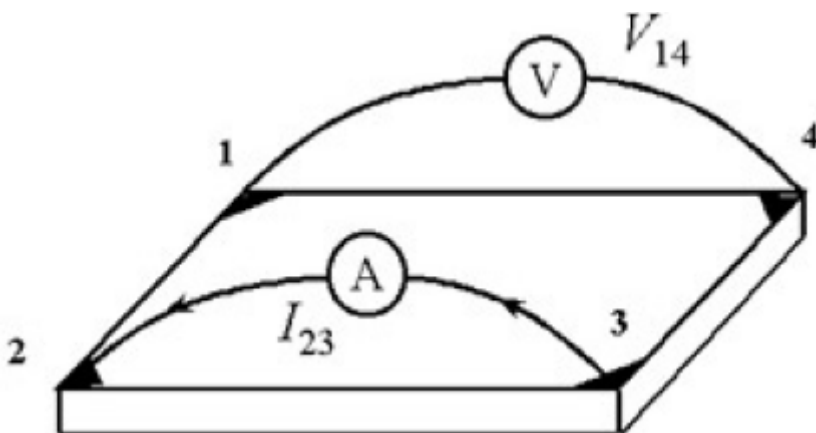
- V praksi  $R_{sh}$  ne izračunamo ampak jo merimo.
- Meritev poteka enako v primeru homogene ali nehomogene plasti

Van der Pauw merilna metoda

$R_{SH}$  lahko izračunamo, če prej izmerimo  $R_A$  in  $R_B$



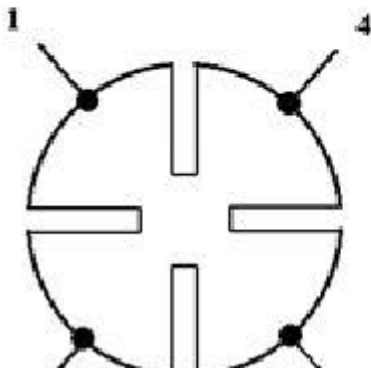
$$R_A = \frac{V_{43}}{I_{12}}$$



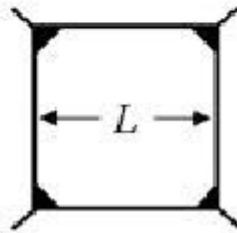
$$R_B = \frac{V_{14}}{I_{23}}$$

$$e^{-\pi \cdot \frac{R_A}{R_{SH}}} + e^{-\pi \cdot \frac{R_B}{R_{SH}}} = 1$$

### Cloverleaf



### Square or rectangle: contacts at the corners



25. Opišite štiritočkovno meritev  $R_{sh}$  (ang. four-point probe).

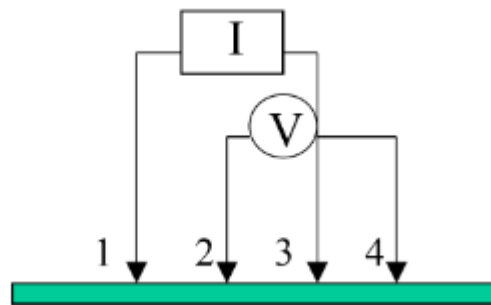
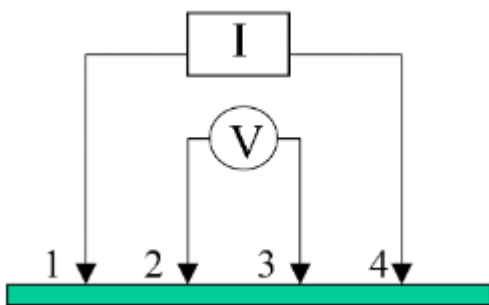
Navedite predpostavke (slabosti) osnovne metode.

Opišite kakšna je njena dejanska uporaba v praksi: Metoda dvojne konfiguracije konic.

- Najbolj pogosta metoda za meritev  $R_{sh}$  materiala.
- Štiri merilne točke kontaktirajo material v ravni črti al v kvadratu.
- metoda minimizira parazitne vplive kontaktnih upornosti  $R_C$
- debelina merjenca  $d < 0.4S$  kjer je S razmik med konicami

$$R_{sh} = \frac{\pi}{\ln 2} \frac{V}{I}$$

$R = R_{sh} d$  kejr je d debelina plasti



- v realnosti mormo upoštevati korekcijske faktorje (CF)
- izračunamo  $R_A$  in  $R_B$  iz dvojne konfiguracije in nato lahko izračunamo  $CF_{geo}$

26. Opišite postopek načrtovanja trakastih plastnih uporov?

Kolikšni so prispevki k upornosti na vogalih in na zaključnih priključkih?

Izračunajte vrednost upora na sliki, če je  $R_{\square} = 0.5 \text{ m}\Omega/\square$

- izhodiščni podatki pri načrtovanju:

- plastna upornost uporovne plasti  $R_{sh}$ ,
- priporočena optimalna širina uporovne proge D,
- želena upornost upora R
- Določiti je potrebno dolžino uporovne proge L

Trakasti plastni upori

- zavite uporovne proge - **meandriran upor**
- obravnavamo s štejetjem št. kvadratov.
- prispevek vogalnega kvadrata je  $0.56R_{sh}$
- srečamo jih v integriranih vezjih zaradi boljše izrabe površine.
- konektorji prispevajo 0.14

## 27. Kako povečamo upornost cilindričnega upora

- tako da povečamo L in zmanjšamo A. V uporovno progo vrezkamo spiralo. Upornost določata tudi širina reza in korak navoja.

$$R = R_{sh} \frac{2\pi r}{s-b} \frac{1}{\cos \phi} \frac{L}{s}$$

## 28. Kaj je kožni pojav? Zakaj pride do izriva toka – razložite z reaktancami.

Narišite primer izriva toka za vodnik kvadratnega prereza.

Označite področja visokih tokovnih gostot.

Kaj je vdorna globina -  $\delta$ ?

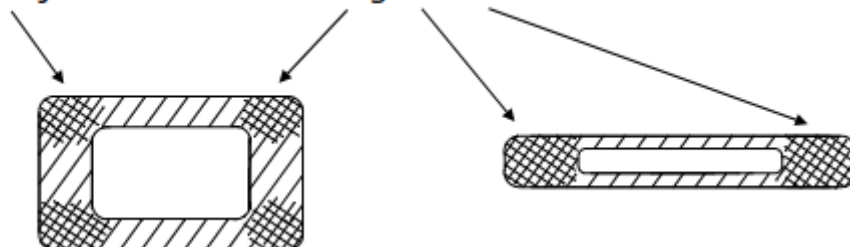
Katerega reda je  $\delta$  za Cu vodnik pri  $f = 1 \text{ Hz}$  in  $1 \text{ MHz}$  ( $\mu\text{m}$ ,  $\text{mm}$ ,  $\text{cm}$ )?

Kako zmanjšamo vpliv kožnega pojava?

krožni pojav - skin effect

- pri VF magnetno polje narašča od površine proti sredini vodnika, zato ima področje v sredini vodnika večjo reaktanco in zato teče predvsem v površinskem delu vodnika.

področja visokih tokovnih gostot



Vdorna globina

- tam kjer tokovna gostota  $j$  vpade na  $1/e$  oz. 37% od vrednosti na površini  $j_0$

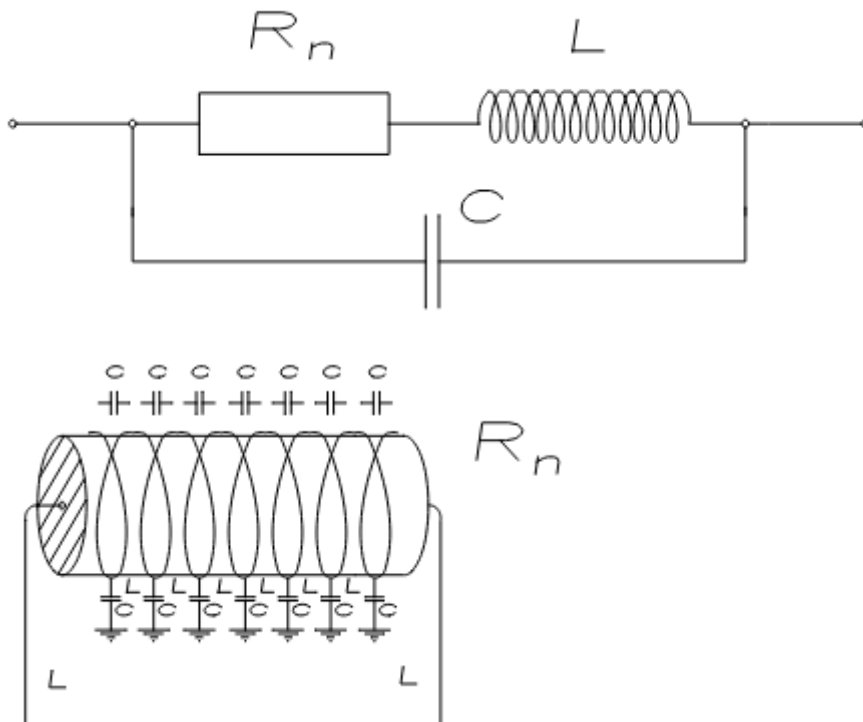
Cu, T=20°C	
f	δ
1 Hz	6.7 cm
1 MHz	67 μm
1 GHz	2 μm
10 GHz	0.67 μm

zmanjšanje vpliva - uporabimo pletenico - več tankih vlaken

29. Narišite VF nadomestno vezje žičnega upora, v katerem predstavite vplive parazitnih elementov.

Zapišite enačbo za impedanca upora -  $|Z(f)|$  ter narišite njen frekvenčni potek.

Na poteku  $|Z(f)|$  izpostavite razliko med žičnim močnostnim uporom (npr. 3 W) in CF uporom moči 0.25 W.



$$\hat{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R_n + j\omega L} + j\omega C}$$

- frekvenčna odvisnost upornosti:
  - pri plastnih uporih pride vpliv stresanih kapacitivnosti
  - pri žičnih uporih pride do skin effect.

### Wirewound vs. Metal Film Resistors

	Wirewound	Metal Film
Tolerance	Best	
Stability	Best	
TCR	Best*	
Rise Time		Best
Size		Best
Cost		Best

### 30. Kakšne strukture uporov so primerne za VF delovanje?

Kako zmanjšamo vpliv parazitnih kapacitivnosti/induktivnosti?

Kaj sta bifilarno in Ayrton-Perry navijanje?

- za VF so primerni miniaturni nespiralizirani tankoplastni upori → neznaten skin effect
  - nima ovojev nima parazitnih L
  - nima velikih parazitnih C in I ker je majhen

zmanjšanje vpliva parazitnih kap. in ind.

- Bifilarno navijanje
- Ayrton Perry navijanje - slabost 4x več žice gre

### 31. Zakaj časovni prostor ni primeren za opis šuma?

Kolikšna je povprečna vrednost šuma?

Kako je podana šumna napetost nasploh?

Zapišite izraz za termični šum na uporju?

Zakaj se pojavlja termični šum?

Kakšen je spekter tega šuma?

Do katere frekvence je spekter šuma res "bel"?

Katerega reda je šum na 1 kΩ uporju v frekvenčnem pasu 100 kHz pri sobni temperaturi (X μV, XX μV, XXX μV, X mV)?

Kako lahko termični šum na uporju znižamo?

Kako predstavimo šum na uporju - narišite šumno nadomestno vezje upora?

Za časovni opis bi rabili neskončno podatkov

Povprečna vrednost je 0

šum podamo v RMS efektivni vrednosti

Termični šum - saj ga lahko obrazložimo s termodinamiko

Šum je zares bel do mejne frekvence  $10^{13}$  Hz to je frekvenca elektronov.

$$1k\Omega \rightarrow 0.01\mu V/V$$
$$100k\Omega \rightarrow 0.1\mu V/V$$

Termični šum znižamo z zmanjšanjem upornost  $R$  ali frekvenčnega pasu  $\Delta f$ , kar pomeni spremenjeni načrt elektronskega vezja, ali pa uporabimo hlajenje vezji in naprav na nizke temperature (T)

Šumno nadomestno vezje za upor je upor plus šumi generator.

### 32. Zakaj nastane tokovni šum na uporju?

**Kakšne oblike je spekter tega šuma?**

**Zapišite izraz za tokovni šum na uporju?**

**Kakšnega reda je velikost tokovnega šuma za 1 k $\Omega$  CF upor v pasovni širini 100 kHz (X  $\mu$ V, XX  $\mu$ V, XXX  $\mu$ V, X mV)?**

Tokovni šum nastane zaradi naključnega spreminjanja kontaktnih upornosti med zrni materiala.

Zaradi frekvenčnega poteka spada pod 1/f šum (pink noise)

$$\frac{\sqrt{v_n^2}}{V} = \frac{\sqrt{\Delta R_n^2}}{R}$$

$$1k\Omega \rightarrow 0.01\mu V/V$$
$$100k\Omega \rightarrow 0.1\mu V/V$$

### 33. Kakšen je prispevek šuma na ostalih elementih (kondenzatorjih, tuljavah, virih)?

**Kateri so poglavitni vzroki šuma na teh elementih?**

Največ šuma prispevajo upori in aktivni elementi, kondenzatorji, tuljave in izvori so zanemarljivo majni

nastane zaradi naključne narave termičnega gibanja

### 34. Katere vrste šuma prevladujejo pri MOSFET?

**Kaj je zrnati šum? Pri katerih elementih nastopa?**

**Narišite šumno nadomestno vezje PN diode za majhne signale.**

**Od česa je odvisna velikost šumnega generatorja v vezju?**

**Kako določimo vrednost diferencialne upornosti  $r_D$  v nadomestnem vezju?**

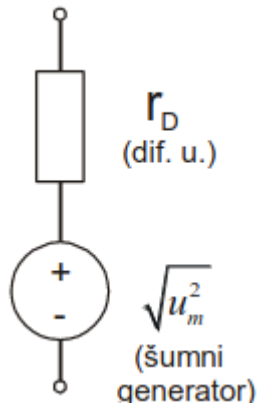
pri MOSFET prevladuje termalni šum, nato 1/f šum, zrnati šum

Zrnati šum se pojavi, kadar morajo elektroni v komponenti premagati potencialno bariero z lastno kinetično energijo. Ker je kinetična energija porazdeljena naključno med elektrone, bodo tudi prehodi elektronov naključni in zato tudi tok šumi.



Šumno nadomestno vezje diode za majhne signale.

- diodo nadomestimo z diferencialno upornostjo.



velikost šumnega generatorja je odvisna od frekvence

$$i_n = 2 \cdot q \cdot I_D \cdot \Delta f$$

vrednost diferencialne upornosti kako določimo? ?

**35. Naštejte korake postoka določitve šuma v vezju.**

**Kaj pomeni, da so šumni generatorji nekorelirani?**

**Prikažite primer določitve šuma na vezju zaporedno vezanega upora in diode, ki sta priključena na napetostni vir. Kaj je šumna mejna frekvenca v vezju?**

Koraki določitve šuma:

- elemente nadomestimo z šumnimi nadomestnimi vezji
- z metodo superpozicije določimo trenutno šumno napetost v izbrani točki.
- šumne generatorje obravnavamo kot običajne generatorje, katerih časovna odvisnost je v celoti poznana.
- Rezultat je šumna napetost v izbrani točki vezja.

Priemr zaporedno vezan upor in dioda.

- šum na upor  $\overline{V_j^2} = 4kTBR$
- šum na diodi ima še zrnat šum  $\overline{V_s^2} = 2qIBR^2$
- RMS je vsota obeh:  $\overline{V_{out}^2} = \overline{V_j^2} + \overline{V_s^2}$

Šumna mejna frekvenca je točka frekvenčnega spektra operacijskega ojačevalnika OPA, kjer je beli šum postane enak 1/f šumu (noise corner frequency)

**36. Kateri izhodiščni material plasti uporabljamo za izdelavo CF in MF plastnih uporov?**

**S katerim postopkom nanašamo plast na MF upore?**

**Kaj je spiralizacija uporov? S katerimi napravami upore spiraliziramo?**

**Kakšen red (X kΩ, XX kΩ, XXX kΩ, X MΩ) upornosti dosegamo za CF in MF upore brez**

**spiralizacije?**

**Zakaj CF uporov ne moremo uspešno pospešeno starati na višji temperaturi?**

**Kakšen je TKR CF uporov?**

**Kateri upori so bolj stabilni (CF, MF)?**

**Pri katerih uporih (CF, MF) dosegamo večje  $P_n$  pri istih dimenzijah?**

**Kateri upori imajo višjo mejno napetost ( $U_m$ )?**

CF - carbon film - ogljenoplastni upori

MF - metal film - metalplastni upori

izhodiščni material so valjasta telesa iz visoko čiste keramike

nanašanje uporovne plasti za CF upre - s pirolizo (high temp. pyrolysis)

nanašanje uporovne plasti na MF upore - breztokovno elektrokemijsko depozicijo. (electroless plating)

vrezovanje spirale - spiralizacija

max upornost brez spiralizacije v rangi  $k\Omega$

CF bi oksidiral na visoki temperaturi

$TK_R$  CF upora je negativen in raste z  $R_n$

pri MF je loh + ali - in raste z  $R_n$

MF so bolj stabilni.

Pri MF dosegamo večje  $P_n$  pri istih dimenzijah

nism sure kdo ma višjo mejno napetost ampak mislim da MF

**37. Za katere aplikacije bi uporabili žični upor namesto plastnega?**

**Ali z žičnimi upori dosežemo boljše temperaturno kompenzacijo kot s plastnimi?**

**Kako dosežemo najboljšo temperaturno kompenzacijo žičnega upora?**

**Katere zlitine se uporabljajo pri tem? Kolikšen je red TK R teh zlitin?**

**Kolikšen je red T MAX močnostnih žičnih uporov (1XX °C, 2XX °C, 3XX °C, 4XX °C)?**

**Kolikšen je T MAX plastnih uporov?**

Žični upori dosegajo boljše temp. kompenzacijo.

dosežemo boljše temp. kompenzacijo tako da zberemo pravo razmerje materialov z različnimi TKr npr. manganin (TKr = +10ppm/K) in konstantan (TKr = -40 ppm/K)

žični  $T_{max} = 400^\circ C$

MF  $T_{max} = 175^\circ C$

$$CF\ T_{max} = 155^{\circ}C$$

### **38. Kaj je Metal Electrode Leadless Face (MELF)?**

**V čem je razlika med klasičnim plastnim uporom in MELF uporom?**

**Ali se postopek izdelave MELF uporov razlikuje od klasičnih plastnih uporov?**

**S katerim postopkom nanašajo uporovno plast pri kvadrastih SMD uporih?**

**Pri katerih integriranih uporih še srečamo ta postopek?**

MELF - kontakti so zvedeni z vtisnjenimi kovinskimi kapicami, zastarelo noben več ne uporablja to je nek poskus met smd koponente brez da kej dost spremeniš proces izdelave ampak imajo slabosti in še rolajo se po mizi.

SMD se razlikuje: notranja metalizacija in uporovna plast izdelana s postopkom tiskanja, nato pa vtisnjene kovinske kapice.

natiskanje srečamo še pri debeloplastnih uporih.

### **39. Kako so izdelani integrirani upori v tankoplastni hibridni tehnologiji ( $d \approx 1\ \mu m$ )?**

**Kateri material je najbolj razširjen pri teh uporih?**

**Kaj je naprševanje - opišite postopek iz filma, ki smo si ga ogledali?**

Tankoplastni hibridni upori postopek izdelave:

- na keramičen substrat je nanescena tanka uporovna plast po postopku Physical vapor deposition (PVD) substrat je keramika, steklo, rezina Si.

Najbolj razširjena vrsta plasti - Nichrome (NiCr) ker ima najmanjši  $TC_R$

### **40. Kako so izdelani integrirani upori v debeloplastni hibridni tehnologiji ( $d \approx 10 - 50\ \mu m$ )?**

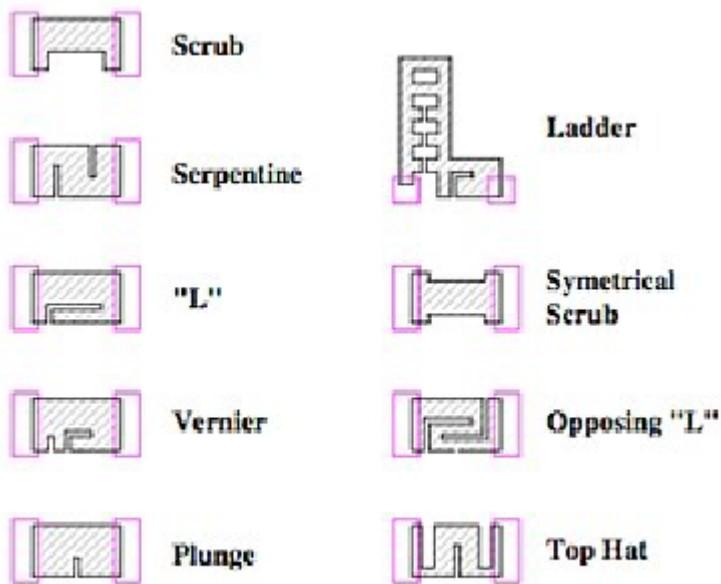
**Kateri postopek je v uporabi za nanos uporovne paste?**

**Kako poteka trmanje debeloplastnih hibridnih uporov?**

**Narišite "top hat" laserski rez.**

Debeloplastni upori - izdelava:

- na keramični substrat je natiskana (screen printing) uporovna pasta ( $RuO_2$ )
- uporovno plast zapečemo na predpisani temperaturi
- nato se isti postopek ponovi z metalizacijo (nanašanje, fotolitografija)



Trim Configurations

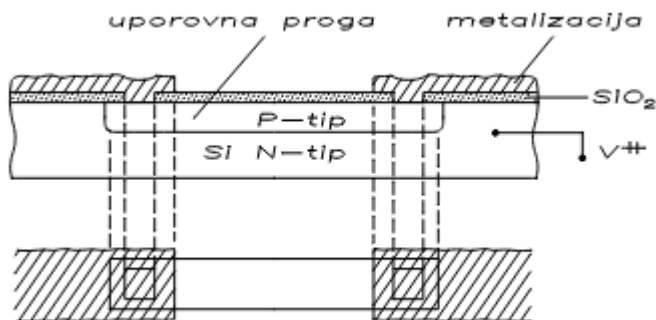
41. S katerim postopkom izdelamo uporovno progo v polprevodniku?

Narišite prerez strukture Si polprevodniškega upora.

Na kateri potencial priključimo Si-N tip polprevodnika?

Uporovno progo na polprevodniku izdelamo s selektivnim vnašanjem primesi v polprevodnik:

- z difuzijo
  - z ionsko implantacijo
- substrat je monokristal polprevodnika



Med delovanjem morajo biti vsi elementi (tudi upor) integriranega vezja električno ločeni, kar dosežemo z zaporedno polarizacijo PN spoja upora - substrat.

substrat (bulk) priključimo na najbolj pozitiven potencial v vezju - običajno pozitivna napajalna napetost.

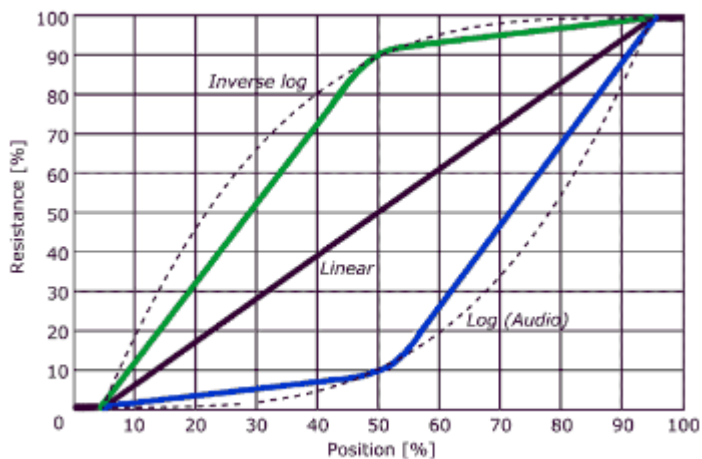
42. V čem je razlika med trimmerjem in navadnim potenciometrom?

Kakšne odvisnosti upornosti od lege drsnika (taper curve) poznamo?

Zakaj se uporabljajo logaritemski potenciometri?

Razlika med trimmerjem in potenciometrom je ta, da ima potenciometer gumb za nastavljanje, trimmer pa je mišljen da ga nastaviš enkrat in pol nanj pozabiš.

## Taper curve

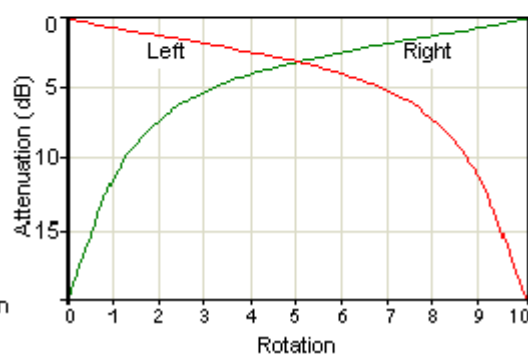
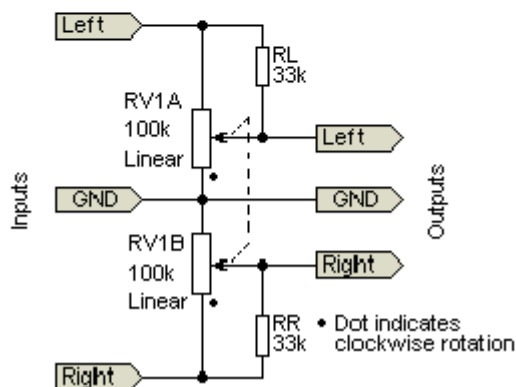
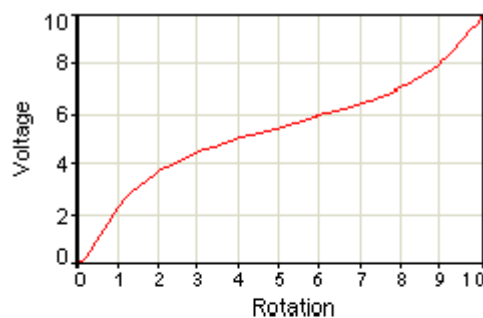
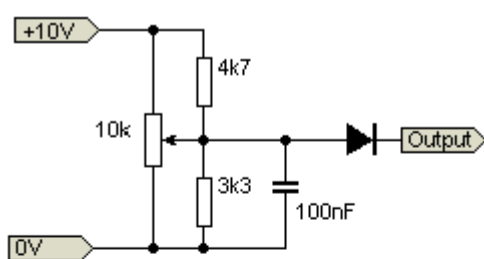


linearni, logaritmični, Inverzni logaritmični, "S" taper curve

logaritemski je uporaben za audio glasnost

S taper je uporaben za kontrolo moči na žarnicah.

## 43. Kako izvedemo "S" potek upornosti potenciometra in log-antilog potekov z linearnimi potenciometri?



## 44. Na kakšne načine lahko merimo električni tok?

Zakaj je meritev s pomočjo upora najprimernejša?

Katere so slabosti tega načina meritve?

Kakšne težave nastopijo pri meritvah upornosti reda mΩ?

Zakaj imajo upori za meritev toka praviloma 4 priključke?

Kakšna je primerna merilna metoda?

Upori za meritev toka - current sense resistors

dobro ker prevedemo problem na meritev napetosti.

poceni je

slabo ker se troši moč

in slabo kerni izolacije med vezjem in velikim tokom in merilnim vezjem

če je upor različne temperature pride to termične napetosti.

Štiri priključki - Kelvin configuration

- omogočijo, da je tok dan na enih in merimo na drugih dveh priključkih.

Kelvin konfiguracija prepreči temperaturne in uporovne koeficiente priključkov in je zato bolj natančno.

## Nelinearni upori

1. Narišite električni simbol in karakteristiko  $R(T)$  NTC termistorja.

Kakšne velikosti je TK R teh elementov (X%/K, XX%/K)?

Zapišite enačbo  $R(T)$  NTC elementa.

Zakaj je konstanta (B) pomembna za karakterizacijo NTC?

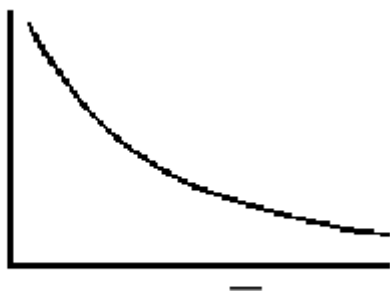
Zakaj ima konstanta (A) večje spremembe od (B)?

Kakšen je velikostni razred konstante B (X K, XX K, XXX K, XXXX K)?

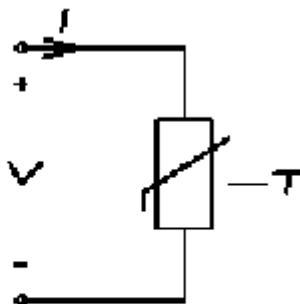
Zapišite izraz za temperaturni koeficient upornosti NTC termistorja.

Kako določimo materialno konstanto B NTC?

V kakšnih tolerančnih razredih obstajajo klasični diskasti NTC elementi (0.1%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%)?



$R(T)$  karakteristika



simbol NTC

TKr je od -1 do -7 %/K tipično

enačba NTC elenta

$$R(T) = Ae^{\frac{B}{T}}$$

konstanta  $A$  je  $R_{min}$  termistorja za visoke temperature, ki je določena z geometrijo ( $S, l$ ) in koncentracijo dodanih primesi

Materialna konstanta  $B$  je določena z vezalno energijo prostih nosilcev  
 $B \approx (2000K \dots 5000K)$

določitev materialne konstante  $B$

$$B = \frac{\ln \frac{R_1}{R_2}}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$$

$$TK_R = -\frac{B}{T^2}$$

so v tolerančnih razredih 20% , 10%

## 2. Kateri izhodiščni material se uporablja pri izdelavi NTC?

**Kaj je sintranje?**

**Razložite NTC efekt na primeru keramike N-tipa.**

**Kakšna je odvisnost koncentracije elektronov  $n(T)$  od temperature v N-tipu keramike?**

**Kako se  $n(T)$  odraža v enačbi za specifično upornost in posledično celotno upornost?**

Za izdelavno NTC termistorjev, so zmesi kovinskih oksidov: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

postopek izdelave:

- zmes konvisnih oksidov ZnO prah
- dodajo primesi in vezavo,
- pasto oblikujejo
- Žgejo (sintranje) pri visoki temperaturi.
- Kontakti iz prevodne metalne plasti
- Obvezno pospešeno staranje, ker imajo v začetnem obdobju termistorji velike variacije lastnosti.

Efekt NTC N-tipa:

Če  $T$  raste  $R$  pada, ker raste število prostih nosilcev - elektronov

Efekt NTC P-tipa:

Če  $T$  raste  $R$  pada, ker raste število prostih nosilcev - verzele

Temperaturna odvisnost upornosti

V polprevodniški keramiki koncentracija prostih nosilcev eksponentno raste s temperaturo. V keramiki N-tipa:

$$n(T) = n_{\infty} e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

## Kondenzatorji

**\*\*1. Zakaj ima kondenzator dielektrik? Kaj je relativna dielektričnost?**

Kaj se zgodi z el. poljem, če med plošče vstavimo dielektrik?

Kaj se zgodi pri polarizaciji dielektrika, če je el. polje večje od 0? \*\*

## Dielektrik

- Mehanska ločitev elektrod
- Višjo prebojno napetost kot zrak
- poveča kapacitivnost za faktor relativne dielektričnosti  $\epsilon_r$

## Polarizacija dielektrika

- Polarizacija dielektrika opisuje stopnjo urejenosti električnih dipolov v dielektriku:
- $E=0 \Rightarrow$  molekule neurejene, vse smeri so zastopane enakomerno  $\Rightarrow$  totalni dipolni moment na enoto volumna oz. polarizacija je enaka 0
- $E \neq 0 \Rightarrow$  polarne molekule se uredijo v smeri polja  $\Rightarrow$  V primeru nepolarnih molekul pride pred tem najprej do inducirane dipolnega momenta ko se zaradi nasprotnih električnih sil razmakneta centra pozitivnega in negativnega naboja in s tem vzbudi dipolni moment. Nato se inducirani dipolni momenti uredijo v smeri polja.
- $E \neq 0 \Rightarrow$  se električni dipolni momenti v dielektričnem materialu uredijo oz. dielektrik se polarizira.
- Opisana ureditev dipolov ima važne posledice za lastnosti kondenzatorja:
  - pozitivne (npr. povečanje kapacitivnosti) in
  - negativne (npr. dielektrična absorpcija)

## 2. Kaj je dielektrična absorpcija? Kaj je novonastala napetost (VR)?

Kakšen vpliv ima dielektrična absorpcija na kapacitivnost in časovni odziv kondenzatorja?

### dielektrična absorpcija

C nabijemo, na hitro izpraznimo, čez nekaj časa pomerimo napetost na odprtih sponkah, ugotovimo da se ponovno pojavila neka napetost! Vzrok je dielektrična absorpcija

